

电子元器件

行业分析

2019年10月：季报显示行业见底，回升预期 先关注下游需求再向上传导

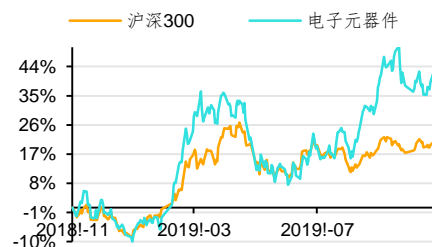
投资要点

- ◆ **行业指数弱于市场整体，基本面成核心关注点：**2019年10月国内A股市场的中信电子元器件行业一级指数下跌0.2%，位列第13位，跑输沪深300、中小板和创业板指数，二级指数中各子行业有涨有跌。海外市场方面，美国和台湾走势显著强于所在市场整体，而香港方面弱于市场整体。
- ◆ **终端穿戴关注度高于手机，智能化渗透延续：**10月消费电子在核心厂商新品发布后出货量成为了关注点，智能手机创新亮点有限，苹果的价格策略带来了出货量提升，安卓阵营则华为国内市场此消彼长侵占OV小米份额。可穿戴设备苹果AirPods关注度较高，其他厂商也跟进推出新的同类型产品，我们认为包括耳机、手表、VR/AR、智能电视等产品将会是行业更重要的关注点。
- ◆ **半导体国产化替代影响显现，代工和封测厂实质性受益：**行业数据显示行业下行过程仍然在延续，但是跌幅明显收窄，存储器价格在7月显著上涨基本也出现了企稳，行业市场见底基本能够确认，回升仍然有待观察。国产化替代从第三季度的业绩看到了相关效果，未来设计厂商要进一步拓展份额将面临技术储备和开发投入的挑战，短期存在不确定性，而代工和封测厂实质性受益将会更为确定。
- ◆ **面板市场价格持续下跌，行业延续底部调整期：**显示屏市场的价格再次出现了回落，尤其是大屏市场的价格持续下行，中小尺寸相对较为平稳，市场仍然显示出较为薄弱的供需关系，2020年OLED和Mini-LED背光显示有望给市场供需带来新的变化。而在LED显示领域，应用场景拓宽带来的下游需求端订单充足，结合上游供给端去产能接近尾声，行业有望迎来上行机会。
- ◆ **投资建议：**11月的投资机会我们认为，三季度单季度行业整体和子版块均出现了较为显著的业绩回升，其中半导体子版块大幅反弹，我们对反弹持续性保持谨慎，目前较为明确的是行业触底的预期。消费终端的产业链龙头厂商应获得更高关注度，芯片国产化在Q4有望延续惯性，因此同季度策略保持一致将评级上调至“领先大市-B”，但是仍然建议回避高估值和业绩波动风险太大的标的。关注子行业首选维持不变，仍然是消费电子板块，包括视频监控和元器件板块。个股核心推荐标的为立讯精密(002475)、长盈精密(300115)、莱宝高科(002106)、海康威视(002415)和江海股份(002484)。
- ◆ **风险提示：**终端新品实际需求增速不及预期；终端产品功能方面创新无法达到消费者认可；贸易争端带来的终端需求变化以及产业链影响的不确定性；国产化自主可控的产业政策推出与落地实施不及预期风险。

 投资评级 **领先大市-B 上调**

首选股票		评级
002475	立讯精密	买入-A
300115	长盈精密	买入-B
002106	莱宝高科	增持-A
002415	海康威视	买入-A
002484	江海股份	买入-B

一年行业表现



资料来源：贝格数据

升幅%	1M	3M	12M
相对收益	-2.54	9.87	18.77
绝对收益	1.07	15.34	38.89

分析师

蔡景彦

SAC 执业证书编号：S0910516110001

caijingyan@huajinsc.cn

021-20377068

报告联系人

郑超君

zhengchaojun@huajinsc.cn

相关报告

电子元器件：Mate X 折叠屏正式发布，国产化业绩有所兑现 2019-10-27

电子元器件：华为三季度终端向好，关注供应链业绩数据 2019-10-20

电子元器件：终端新品发布基本完成，三季度业绩受关注 2019-10-13

电子元器件：2019年9月：终端新品推动情绪，业绩期来临验证基本面 2019-10-02

电子元器件：终端新品持续发布，行业再次领涨 2019-09-22

内容目录

一、核心观点及投资建议	4
二、行业动态分析	5
(一) 产业数据跟踪	5
1、半导体行业数据汇总	5
2、消费电子行业数据汇总	8
3、面板行业数据汇总	9
(二) 行业新闻汇总	10
三、市场走势分析	18
(一) 国内 A 股市场走势分析	18
(二) 海外市场走势分析	19
1、香港	19
2、北美	20
3、台湾	21
四、投资建议及个股动态	22
1、立讯精密 (002475)	23
2、长盈精密 (300115)	23
3、莱宝高科 (002106)	24
4、海康威视 (002415)	24
5、江海股份 (002484)	25
五、风险提示	26

图表目录

图 1: 全球半导体销售收入(十亿美元)及增速 (2018.08 ~ 2019.08)	5
图 2: 美洲半导体销售收入及增速 (2018.08 ~ 2019.08)	6
图 3: 欧洲半导体销售收入及增速 (2018.08 ~ 2019.08)	6
图 4: 亚太半导体销售收入及增速 (2018.08 ~ 2019.08)	6
图 5: 日本半导体销售收入及增速 (2018.08 ~ 2019.08)	6
图 6: 中国大陆半导体销售收入及增速 (2018.08 ~ 2019.08)	6
图 7: 亚太除中国半导体销售收入及增速 (2018.08 ~ 2019.08)	6
图 8: 北美半导体设备出货额及增长率 (2018.09 ~ 2019.09)	7
图 9: 日本半导体设备出货额及增长率 (2018.09 ~ 2019.09)	7
图 10: DRAM 现货平均价 (2018.11 ~ 2019.10)	7
图 11: NAND Flash 现货平均价 (2018.11 ~ 2019.10)	7
图 12: 台积电月度营收及增速 (2018.09 ~ 2019.09)	7
图 13: 日月光月度营收及增速 (2018.09 ~ 2019.09)	7
图 14: 联发科月度营收及增速 (2018.09 ~ 2019.09)	8
图 15: 中美晶月度营收及增速 (2018.09 ~ 2019.09)	8
图 16: 全国手机出货量及增速 (2018.09 ~ 2019.09)	8
图 17: 国内品牌手机出货量及增速 (2018.09 ~ 2019.09)	8
图 18: 全国手机新机型上市量及增速 (2018.09 ~ 2019.09)	8
图 19: 国内品牌手机新机型上市量及增速 (2018.09 ~ 2019.09)	8
图 20: 鸿海月度营收及增速 (2018.09 ~ 2019.09)	9

图 21: 大立光月度营收及增速 (2018.09 ~ 2019.09)	9
图 22: TPK 月度营收及增速 (2018.09 ~ 2019.09)	9
图 23: 群创光电月度营收及增速 (2018.09 ~ 2019.09)	9
图 24: 7 英寸面板价格及环比增速 (2018.10 ~ 2019.10)	9
图 25: 14 寸面板价格及环比增速 (2018.10 ~ 2019.10)	9
图 26: 32 英寸面板价格及环比增速 (2018.10 ~ 2019.10)	10
图 27: 55 英寸面板价格及环比增速 (2018.10 ~ 2019.10)	10
图 28: 中信行业一级指数涨跌幅	18
图 29: 电子一级指数 v.s. 市场整体指数	18
图 30: 电子一级指数 v.s. 沪深 300 指数	18
图 31: 电子二级指数 v.s. 电子一级指数	19
图 32: 电子二级指数 v.s. 电子一级指数	19
图 33: 恒生资讯科技指数 v.s. 市场指数	20
图 34: 恒生资讯科技指数 v.s. 恒生指数	20
图 35: 费城半导体指数 v.s. 市场指数	20
图 36: 费城半导体指数 v.s. 标普 500 指数	20
图 37: 台湾资讯科技指数 v.s. 台湾加权指数	21
图 38: 台湾资讯科技指数 v.s. 台湾加权指数	21
图 39: 台湾资讯行业子版块指数	21
图 40: 台湾资讯行业子版块指数 v.s. 资讯行业指数	21
表 1: 电子元器件行业个股投资建议列表	4
表 2: 电子元器件行业个股涨跌幅榜	19
表 3: 香港资讯科技行业个股涨跌幅榜	20
表 4: 电子元器件行业个股投资建议列表	22

一、核心观点及投资建议

四季度仍然处于行业的相对旺季，我们保持审慎乐观，分子行业而言：

消费终端市场：在 9 月各大品牌商发布新品后，10 月旺季的关注点主要来自于两个方面，产品出货量以及 5G 的新品。从目前看，iPhone11 的价格下降带来的出货量提升效果明显，华为三季度在国内占据了 OPPO、Vivo 和小米的份额。不过值得关注的是，以 TWS 耳机为代表的可穿戴设备引发的关注度较高，未来包括手表、VR/AR 等将会是市场的焦点。

半导体市场：行业数据显示行业下行过程在逐步见底，下行收窄趋势明显，存储器价格在 7 月显著上涨后基本企稳，侧面验证行业见底，只是回升时点尚无法确认，长期走势仍取决于行业供需情况。国产化替代在第三季度获益明显，季报数据显示了较好的回升，在未来仍然需要更多的研发投入来应对更多的挑战。从目前看代工厂和封测厂的回升趋势较为明确。

触控显示市场：显示屏市场的价格再次出现了回落，尤其是大屏市场的价格持续下行，中小尺寸相对较为平稳，市场仍然显示出较为薄弱的供需关系，行业仍处于底部调整期。总体供需关系和产品发展的趋势看，由高清/超高清带动的大屏需求，以及由 OLED、Mini LED 驱动的中小屏创新将会在 2020 年有机会。而在 LED 显示领域，应用场景拓宽带来的下游需求端订单充足，结合上游供给端去产能接近尾声，行业有望迎来上行机会。

对于 11 月的投资机会我们认为，在三季度业绩披露完成后可以看到，单季度行业整体和子版块均出现了较为有效的业绩回升，其中半导体子版块大幅度的反弹，我们对反弹持续性保持谨慎，但是对于行业见底的情况我们认为大概率可以确认。11 月策略我们认为与季度策略分享一致，消费终端的产业链龙头厂商关注度提升，另外芯片国产化在 Q4 有望延续惯性，因此维持季度策略的“领先大市-B”评级，但是仍然建议回避高估值和业绩波动风险太大的标的。

关注子行业首选仍然是消费电子板块，视频监控以及部分元器件，则是对贸易战放缓以及国内宏观经济有所改善预期的关注板块。个股核心推荐标的为立讯精密（002475）、长盈精密（300115）、莱宝高科（002106）、海康威视（002415）和江海股份（002484）。

表 1：电子元器件行业个股投资建议列表

代码	名称	市值（亿元）	PE（2018）	PE（2019E）	PE（2020E）	PB
002475.SZ	立讯精密	1,702	62	47	34	9.29
300115.SZ	长盈精密	135	350	29	23	3.06
002106.SZ	莱宝高科	57	25	22	18	1.43
002415.SZ	海康威视	3,023	27	22	19	7.48
002484.SZ	江海股份	52	21	20	17	1.55

资料来源：Wind，华金证券研究所（截止 2019 年 10 月 31 日收盘）

另外，我们建议关注标的包括通富微电（002156）、华天科技（002185）、太极实业（600667）、东软载波（300183）、全志科技（300458）、东软载波（300183）、富瀚微（300613）、博通集成（603068）、欧菲光（002456）、安洁科技（002635）、蓝思科技（300433）、科森科技（603626）、深天马 A（000050）、环旭电子（601231）、奥拓电子（002587）、洲明科技（300232）等。

二、行业动态分析

从行业市场的数据看，半导体行业需求端和供给端的数据均显示行业仍处于去库存的过程中，月度收入连续下降符合预期，北美设备制造商出货金额连续 11 个月同比下降，但供给端与需求端跌幅同步收窄值得关注，存储器产品 DRAM 和 NAND Flash 的价格在 7 月显著上涨后基本企稳。终端市场方面，总体出货量仍同比下滑，9 月新产品集中发布，新机数量同比降幅缩小，台湾产业链厂商出现不同程度的同比增长。面板市场的供过于求局面在短期终端需求不旺盛的情况下持续下跌，行业仍处于下行阶段，我们建议继续观察。

（一）产业数据跟踪

半导体产业数据方面，2019 年 8 月份需求端销售收入同比下跌 14.8%，连续 8 个月出现同比下降的状况，供给端方面，2019 年 9 月半导体设备厂商的出货金额北美下降 6.0%，连续 11 个月下降，而日本同比下降 16.8%，连续 8 个月下降，值得注意的是需求端与供给端降幅同步收窄。存储器价格方面，DRAM 和 NAND Flash 价格在 7 月显著上涨后基本企稳，侧面验证行业见底。

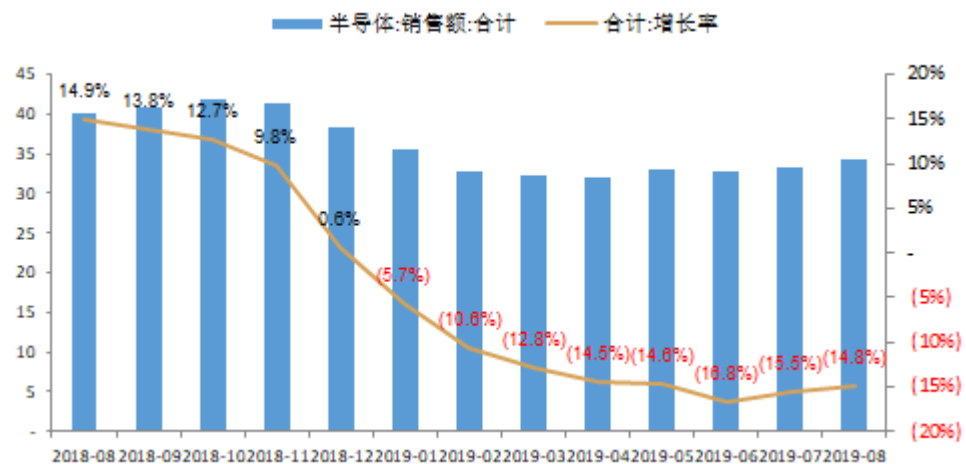
消费电子方面，工信部公布的全国手机出货量进一步下降。2019 年 9 月，全国手机出货量和国产品牌出货量分别同比下滑 7.1% 和 11.2%，新品上市数量分别同比下降 1.1% 和 3.6%，9 月新产品密集发布，新机数量下降幅度环比显著收窄。

面板行业整体的数据显示价格进一步下降，其中，中小尺寸市场价格基本持平，中大尺寸市场价格环比下跌，行业仍持续下行。

1、半导体行业数据汇总

2019 年 8 月，全球半导体销售收入 342.0 亿美元，同比下降 14.8%，自 1 月出现同比下滑以来已连续 8 个月下滑，下滑幅度连续两个月收窄，我们认为短期半导体行业下行预期持续。

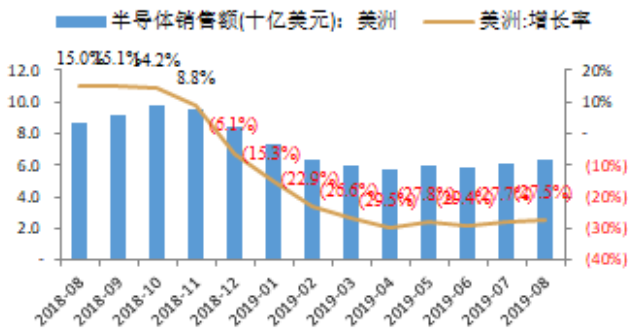
图 1：全球半导体销售收入(十亿美元)及增速（2018.08 ~ 2019.08）



资料来源：Wind、SIA、华金证券研究所

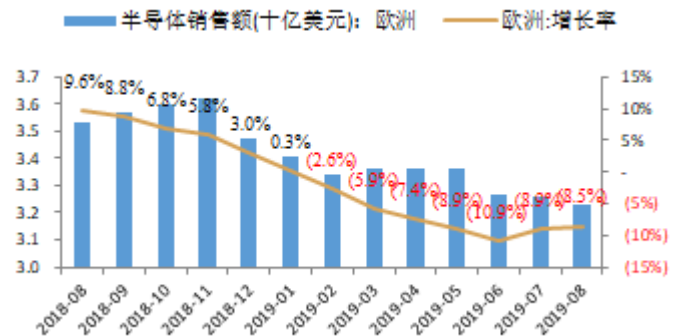
从地区市场分布看，全球市场美洲、欧洲、亚太和日本 4 个主要区域在 2019 年 8 月均同比持续下降，分别下降 27.5%、8.5%、11.8%和 11.2%，各地区下降幅度相比 7 月均有所收窄。

图 2: 美洲半导体销售收入及增速 (2018.08 ~ 2019.08)



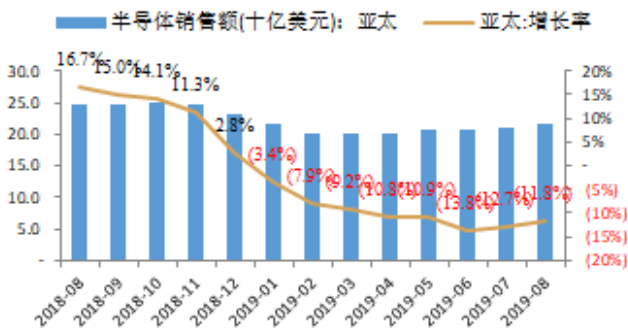
资料来源: Wind、SIA、华金证券研究所

图 3: 欧洲半导体销售收入及增速 (2018.08 ~ 2019.08)



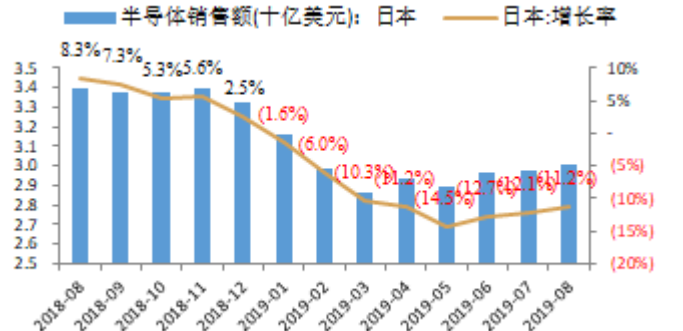
资料来源: Wind、SIA、华金证券研究所

图 4: 亚太半导体销售收入及增速 (2018.08 ~ 2019.08)



资料来源: Wind、SIA、华金证券研究所

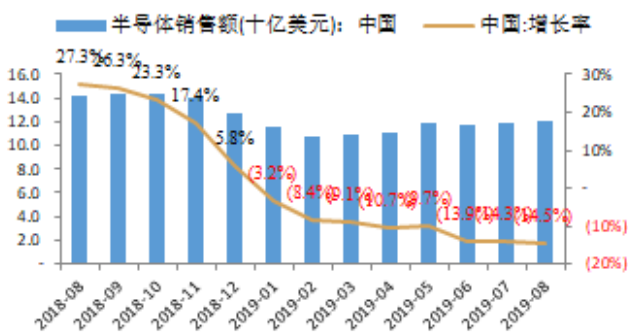
图 5: 日本半导体销售收入及增速 (2018.08 ~ 2019.08)



资料来源: Wind、SIA、华金证券研究所

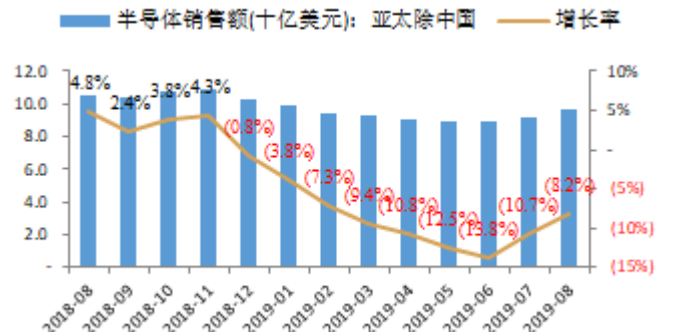
进一步细分亚太市场的数据我们看到，中国大陆地区市场的收入增速下滑 14.5%，而不包含中国大陆地区后收入增速下滑 8.2%，中国大陆地区的下滑幅度大于亚太其他地区。

图 6: 中国大陆半导体销售收入及增速 (2018.08 ~ 2019.08)



资料来源: Wind、SIA、华金证券研究所

图 7: 亚太除中国半导体销售收入及增速 (2018.08 ~ 2019.08)

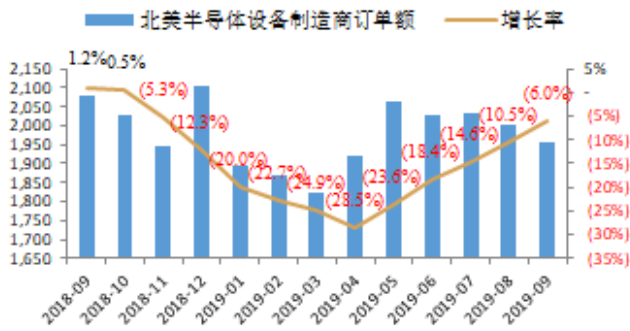


资料来源: Wind、SIA、华金证券研究所

供给端的数据看，Semi 公布的 2019 年 9 月出货额数据为 19.5 亿美元，同比下降 6.0%。SEAJ 公布的 2019 年 9 月动态平均出货额为 1,781.4 亿日元，同比下降 16.8%。可以看到的是，北美的出货额已经连续 11 个月出现了下行，日本则也是连续 8 个月出现了同比负增长，结合需

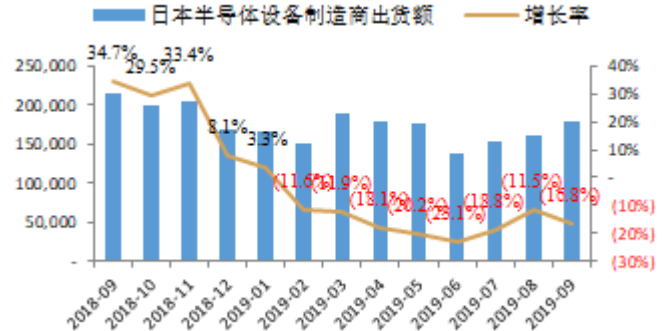
求端数据看，我们认为行业下行的过程仍然在持续，但出货端和需求端的下降幅度同步收窄值得关注。

图 8: 北美半导体设备出货额及增长率 (2018.09 ~ 2019.09)



资料来源: Wind、Semi、华金证券研究所

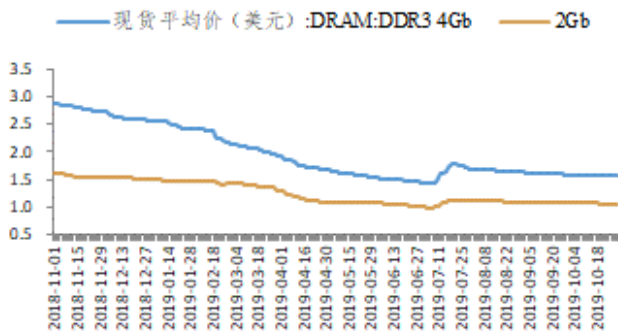
图 9: 日本半导体设备出货额及增长率 (2018.09 ~ 2019.09)



资料来源: Wind、Semi、华金证券研究所

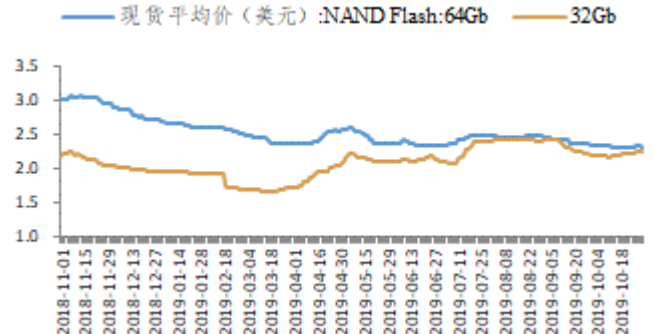
存储器市场看，DRAM 价格在 10 月保持相对稳定，略微有所下降，NAND Flash 价格也保持稳定，32Gb 有小幅提升，行业整体仍处于去库存阶段。

图 10: DRAM 现货平均价 (2018.11 ~ 2019.10)



资料来源: Wind、Semi、华金证券研究所

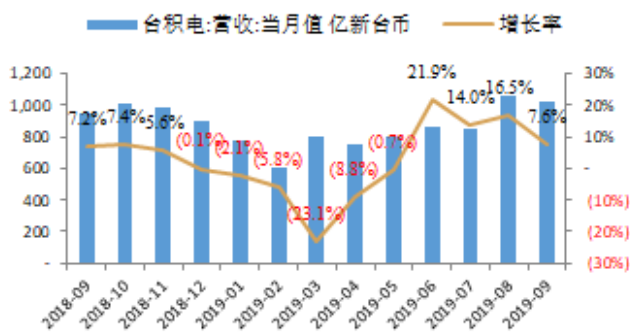
图 11: NAND Flash 现货平均价 (2018.11 ~ 2019.10)



资料来源: Wind、Semi、华金证券研究所

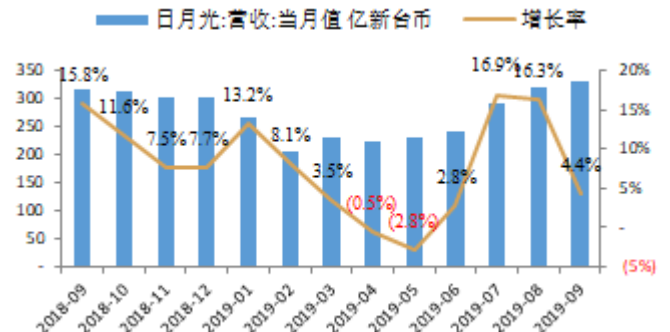
从台湾厂商公布的月度营收数据看，半导体市场在旺季稍有起色，代工、封测和设计端均有不同程度的业绩增长。

图 12: 台积电月度营收及增速 (2018.09 ~ 2019.09)



资料来源: Wind、华金证券研究所

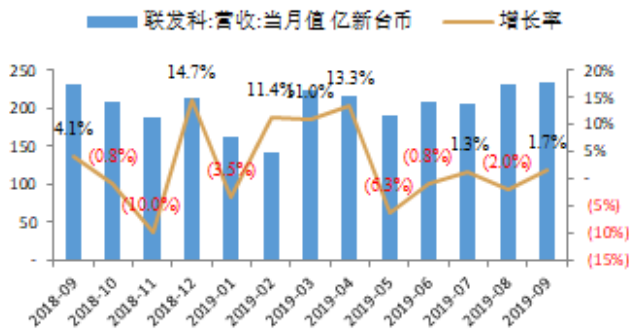
图 13: 日月光月度营收及增速 (2018.09 ~ 2019.09)



资料来源: Wind、华金证券研究所

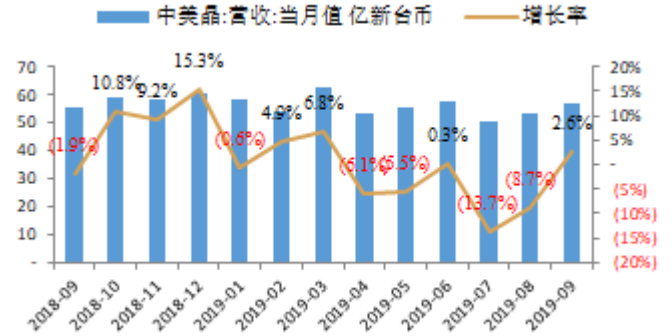
台湾半导体企业经营数据方面，2019 年 9 月台积电营收同比增长 7.6%，业绩已连续 4 个月增长，日月光的营收同比增长 4.4%，相比前两个月同比增幅有所下降。

图 14: 联发科月度营收及增速 (2018.09 ~ 2019.09)



资料来源: Wind, 华金证券研究所

图 15: 中美晶月度营收及增速 (2018.09 ~ 2019.09)



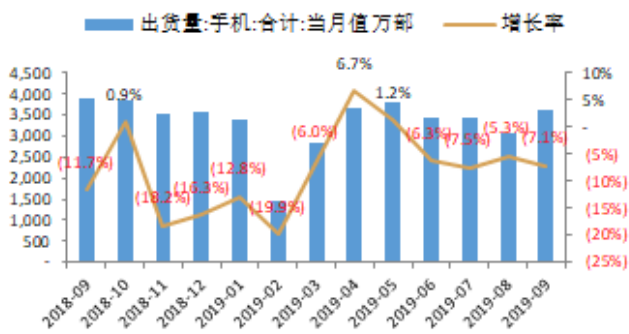
资料来源: Wind, 华金证券研究所

设计厂商方面, 联发科 2019 年 9 月营收同比增长 1.7%, 业绩再次出现同比上升, 上游晶圆厂商中美晶的营收 9 月同比增长 2.6%。

2、消费电子行业数据汇总

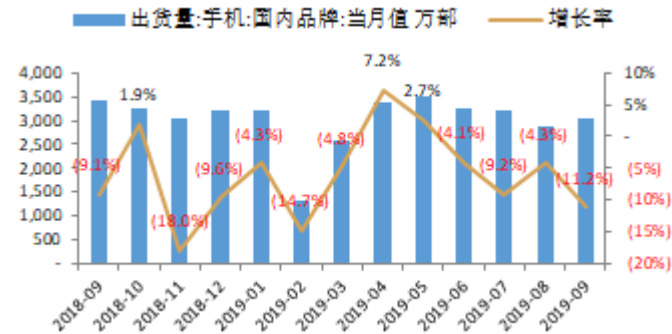
2019 年 9 月, 工信部公布全国手机出货量为 3,623.6 万台, 同比下降 7.1%, 国内品牌手机的出货量为 3,060.9 万台, 占比达到 84.5%, 同比下降 11.2%。

图 16: 全国手机出货量及增速 (2018.09 ~ 2019.09)



资料来源: Wind, 华金证券研究所

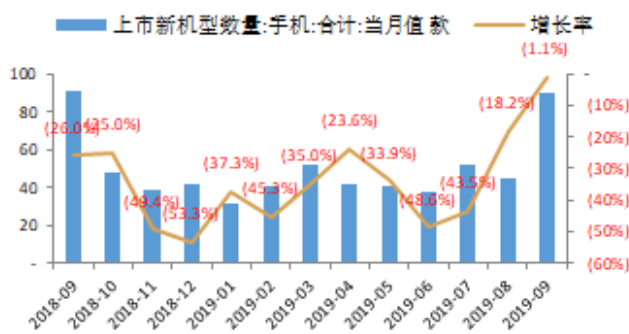
图 17: 国内品牌手机出货量及增速 (2018.09 ~ 2019.09)



资料来源: Wind, 华金证券研究所

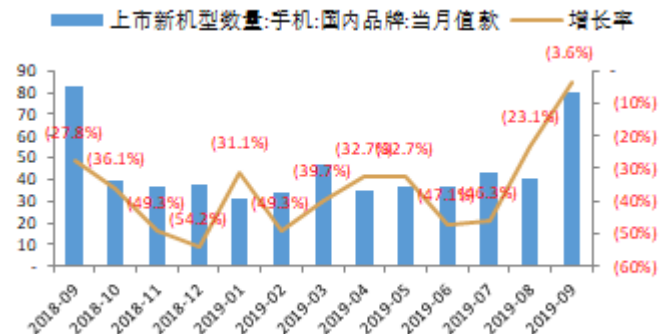
2019 年 9 月, 全国手机新机型上市数量为 90 款, 同比下降 1.1%, 国内品牌手机的新机型上市数量为 80 款, 同比下降 3.6%。

图 18: 全国手机新机型上市量及增速 (2018.09 ~ 2019.09)



资料来源: Wind, 华金证券研究所

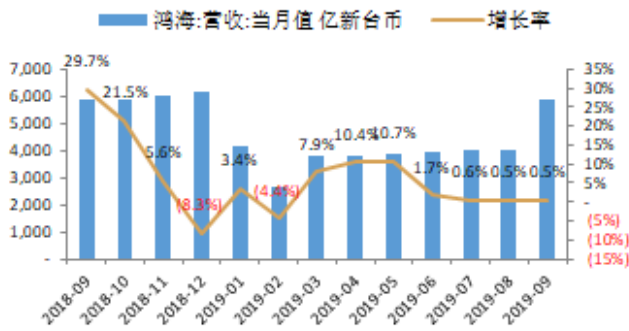
图 19: 国内品牌手机新机型上市量及增速 (2018.09 ~ 2019.09)



资料来源: Wind, 华金证券研究所

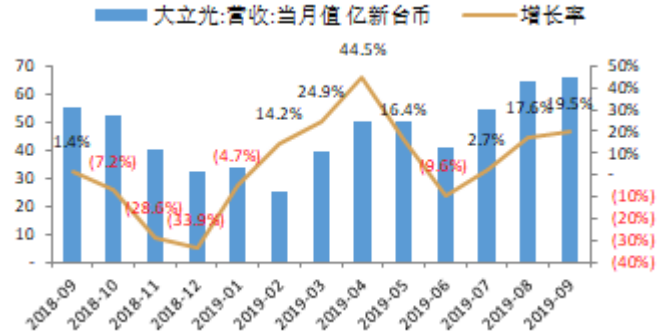
台湾相关产业链的月度营收数据看，9月除面板制造厂商出现了同比下滑，其他组件供应商均出现了不同程度的同比增长。

图 20: 鸿海月度营收及增速 (2018.09 ~ 2019.09)



资料来源: Wind, 华金证券研究所

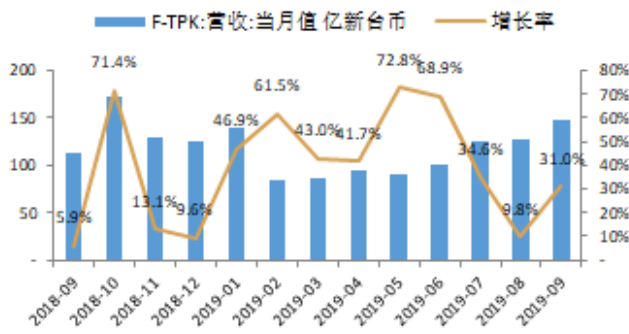
图 21: 大立光月度营收及增速 (2018.09 ~ 2019.09)



资料来源: Wind, 华金证券研究所

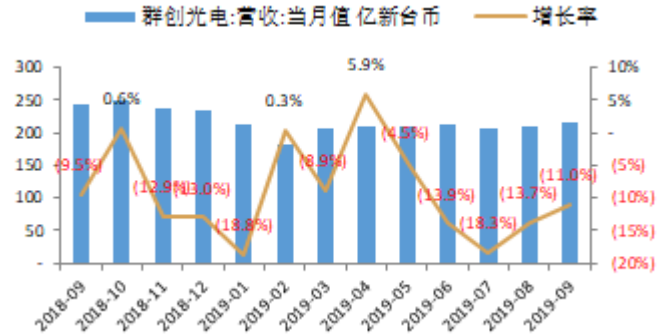
鸿海精密 2019 年 9 月营收同比增长 0.5%，大立光 9 月营收同比增长 19.5%。

图 22: TPK 月度营收及增速 (2018.09 ~ 2019.09)



资料来源: Wind, 华金证券研究所

图 23: 群创光电月度营收及增速 (2018.09 ~ 2019.09)



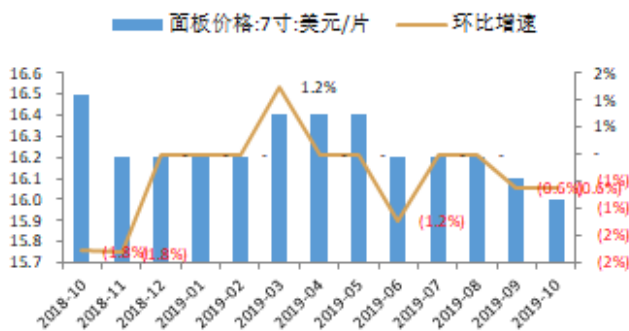
资料来源: Wind, 华金证券研究所

TPK 在 2019 年 9 月营业收入同比上升 31.0%，群创光电营收同比下降 11.0%。

3、面板行业数据汇总

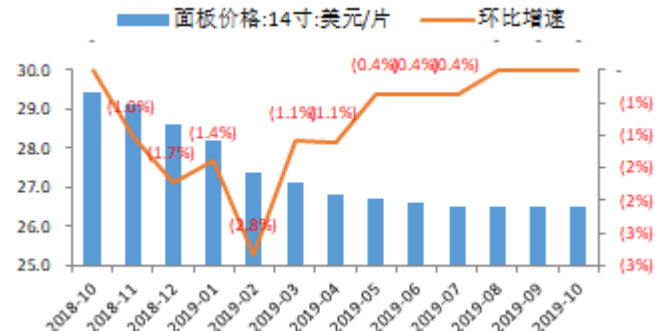
2019 年 10 月，不同尺寸的面板市场价格走势不同，中小尺寸面板价格维持稳定，而中大尺寸面板价格持续下降。

图 24: 7 英寸面板价格及环比增速 (2018.10 ~ 2019.10)



资料来源: Wind, 华金证券研究所

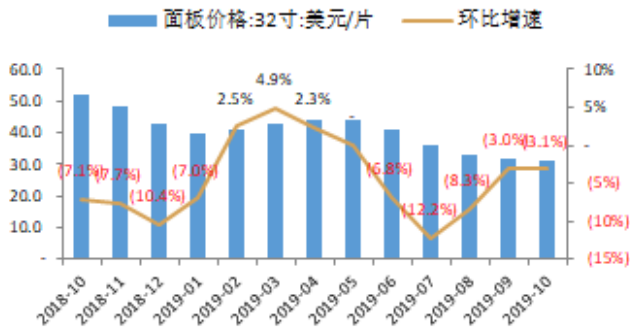
图 25: 14 寸面板价格及环比增速 (2018.10 ~ 2019.10)



资料来源: Wind, 华金证券研究所

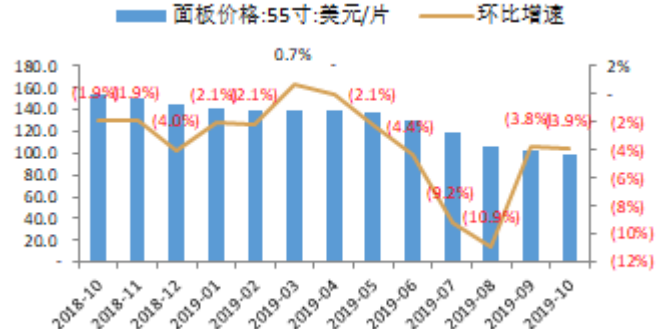
2019年10月,中小尺寸市场7英寸产品价格环比下降0.6%,14英寸产品价格与上月持平。

图 26: 32 英寸面板价格及环比增速 (2018.10 ~ 2019.10)



资料来源: Wind, 华金证券研究所

图 27: 55 英寸面板价格及环比增速 (2018.10 ~ 2019.10)



资料来源: Wind, 华金证券研究所

中大尺寸市场,32寸和55寸的价格分别环比下降3.1%和3.9%。

(二) 行业新闻汇总

5G 商用正式开启:三大运营商套餐 128 元起步 (来源: TechWeb): 在 10 月 31 日举行的 2019 年中国国际信息通信展览会上,工信部与三大运营商举行 5G 商用启动仪式。工信部副部长陈肇雄在 2019 年中国国际信息通信展览会开幕论坛上,宣布 5G 商用正式启动。中国移动、中国联通、中国电信正式公布 5G 套餐,并于 11 月 1 日正式上线 5G 商用套餐。中国联通和中国电信的 5G 套餐从 129 元起步,最高为 599 元;中国移动则从 128 元起步,最高为 598 元。

苹果第四财季营收 640 亿美元 净利同比降 3% (来源: TechWeb): 苹果公司今天发布了 2019 财年第四财季业绩。报告显示,苹果公司第四财季营收为 640.40 亿美元,比去年同期的 629.00 亿美元增长 2%,其中来自于服务的净营收为 125.11 亿美元,创下历史新高;净利润为 136.86 亿美元,比去年同期的 141.25 亿美元下降 3%。苹果公司第四财季大中华区营收为 111.34 亿美元,比去年同期的 114.11 亿美元下降 2%。

Q3 营业利润同比暴跌 56%!三星盈利连续四季度下滑 (来源: CSIA): 北京时间 10 月 31 日,三星电子正式发布截至 2019 年 9 月 30 日第三季度财报。三星 Q3 营业利润达 7.8 万亿韩元(约合 67 亿美元),同比下降 56%,三星营业利润同比已连续四个季度下滑。

外媒:苹果将推出三款 5G 版 iPhone 已开始动员供应商 (来源: TechWeb): 据国外媒体报道,苹果正在动员供应商,准备推出头一批 5G 版 iPhone。知情人士称,苹果将推出三款 5G 版 iPhone,并且已经订出一个激进的销售目标。知情人士称,这三款新 iPhone 将搭载高通设计的 5G 调制解调器芯片。

Canalys:华为手机 Q3 同比增长 66% 苹果小米 OV 大跌 (来源: TechWeb): 科技市场研究公司 Canalys 最新发布的数据显示,2019 年第三季度,中国智能手机市场出货量为 9780 万部,同比下降 3%。其中华为出货量同比增长 66%,达到 4150 万部,市场份额为 42.4%,排名第一。排名二至五位的 Vivo、OPPO、小米和苹果,出货量分别为 1750 万部、1700 万部、880 万部、510 万部,同比分别下降 22%、20%、33%、28%。

三星公开下一代折叠手机设计方案 回归翻盖机 (来源: TechWeb): 据国外媒体报道,当地时间周二三星透露了下一代 Galaxy 可折叠手机的设计。据悉,这是一款可以从上到下折叠的迷你翻盖手机,而不再是像第一代智能手机一样从侧面折叠。与当前的可折叠手机一样,新款可折叠手机也将运行 Android 软件和应用程序。这款手机的屏幕上会有一个打孔摄像头,此外还会有两个后置摄像头。

50 亿元 长电科技控股子公司与大基金等设立合资公司 (来源: 全球半导体观察): 10 月 29 日, 长电科技发布公告, 其控股子公司 STATS ChipPAC Pte. Ltd. (以下简称“星科金朋”) 拟与股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司 (以下简称“大基金”) 等共同投资设立合资公司。公告显示, 长电科技拟将星科金朋拥有的 14 项专有技术及其包含的 586 项专利评估作价, 与大基金、绍兴越城越芯数科股权投资合伙企业 (有限合伙) (以下简称“越芯数科”)、浙江省产业基金有限公司 (以下简称“浙江省产业基金”) 共同投资在绍兴设立合资公司, 建立先进的集成电路封装生产基地。

联发科第三季度净利润达 16 亿元 同比增长 2.5% (来源: TechWeb): 芯片设计公司联发科今日发布了第三季度财报。报告显示, 联发科第三季度净利润为新台币 69.02 亿 (约合人民币 16 亿元), 同比增长 2.5%。第三季营业收入净额为新台币 672 亿 2 千 4 百万元, 较前季增加 9.2%, 较去年同期增加 0.3%。本季营收较前季增加, 主要因智能手机新产品放量及消费性电子季节性需求回升。

格芯和台积电宣布和解 (来源: 今日芯闻): 2019 年 10 月 29 日, 格芯和台积电宣布将撤销两家公司之间的全部诉讼。并且, 两家公司已经同意, 就各自在全球范围内的现有半导体专利以及未来十年内将要申请的专利, 互相给予对方宽泛的专利有效期交叉许可。两家公司均将持续并大量投入半导体技术的研发。

苹果 AirPods Pro 突然发布支持主动降噪售价 1999 元 (来源: TechWeb): 今天凌晨, 备受关注的降噪版苹果 AirPods 正式发布。降噪版 AirPods 官方命名 AirPodsPro, 采用入耳式设计, 支持主动降噪, 10 月 30 日正式开售。AirPodsPro 在保持了前代小巧且真无线的基础上, 加入了主动降噪功能。耳机采用入耳式设计, 官方提供了三种不同大小的耳塞供消费者选择。苹果官方介绍称, AirPodsPro 的降噪功能将会以每秒 200 次的频率持续释放抗噪波, 从而带来更纯净的音质。

高通下一代可穿戴 SOC 曝光: 或将命名为骁龙 Wear 3300 (来源: TechWeb): 据 XDA 报道, 高通正在开发下一代可穿戴设备 SOC。XDA 开发人员发现, 在 Code Aurora 论坛上, 高通为其芯片组上传了 Linux 内核源代码, 在“SDW3300 设备”中发现了文件名“sdw3300-bg-1gb-wtp.dts”, 该代码表明新平台基于骁龙 429 打造, 名为骁龙 Wear 3300。骁龙 429 于 2018 年中推出, 它基于 12nm 工艺制程打造, 采用 4 颗 Cortex A53 核心, CPU 主频为 1.95GHz。报道称高通可能会将这 4 颗 Cortex A53 核心与低功耗协处理器、PMIC、集成 DSP 等与其它组件配合打造新的骁龙可穿戴平台。

英特尔 2019Q3 晶圆厂更新: 10nm 时代开启 7nm 规划之中 (来源: TechWeb): 根据 AnandTech 的报道, 经过数年的拖延, 英特尔终于开始大批量生产其 10nm 制程处理器, 并准备再建一家工厂, 生产更多的 10nm 制程产品。据介绍, 除了生产更多 Ice Lake-U/Y 产品外, 英特尔还计划开发服务器 CPU 和 GPU, 另外 Ice Lake-SP CPU 以及 DG1 GPU 已经在英特尔的实验室中测试。与此同时, 英特尔计划在 2021 年推出基于 EUV 的 7nm 制程。

大基金二期注册资本达 2041.5 亿元, 即将展开新一轮投资布局 (来源: 集微网): 国家集成电路产业投资基金自 2014 年成立以来, 以实际募资 1387.2 亿元实现了对国内集成电路产业链, 包括制造、设计、封测、装备、材料, 以及生态环境等方面的全覆盖, 加速推动了我国集成电路产业的全面发展。如今, 国家集成电路产业投资基金二期呼之欲出, 备受业界期待。10 月 25 日, 集微网通过国家企业信用信息公示系统及天眼查查询显示, 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 (以下简称“大基金二期”) 已于 2019 年 10 月 22 日正式注册成立, 注册资本达 2041.5 亿元, 高于之前行业预估的 1500-2000 亿元。

华为自研 5G 关键芯片 PA: 明年 Q1 季度量产 不再依赖美国 (来源: TechWeb): 华为今年 5 月份被美国列入实体清单, 被禁止采购美国公司的芯片及软件, 所以华为宣布启用备胎计划, 更多芯片将自行研发, 最新消息称华为已经研发 PA 芯片, 将交给国内公司代工, 明年 Q1 季度小幅量产。供应链消息人士手机晶片达人爆料称, 华为自研的 PA, 开始释单给国内的三安集成。明年第一季小量产出, 第二季开始大量。以分散目前集中在台湾的稳懋 PA 代工的风险, 也算是

中国半导体国产化的一环。

Intel 公布今年 Q3 财报, NSG 存储芯片亏损 5 亿美元 (来源: 今日芯闻): 据驱动之家报道, 10 月 25 日, Intel 发布 2019 年 Q3 财报。财报显示, Q3 总营收 192 亿美元, 同比变化不大, 净利润 60 亿美元, 同比下滑了 6%。其中, Intel CCG 部门的 PC 芯片出货量下滑 10%, 但是 Intel 处理器的 ASP 均价还在持续上涨, 笔记本处理器上涨 4%, 桌面处理器上涨 3%。然而 NSG 存储芯片 Q3 营收 12.9 亿美元, 亏损 5 亿美元。

美光发布当前世界最快 SSD X100: Intel 傲腾劲敌 (来源: TechWeb): 美光今天推出 X100 NVMe 企业级 SSD 产品, 直接叫板 Intel 傲腾, 同时也无惧市面上最顶尖的 SLC SSD, 包括三星 Z-Nand、东芝 XL-Flash 等。性能方面, 美光称, X100 的顺序读写速度超过 9GB/s, QD1 队列深度下的随机读速为 250 万 IOPS, 延迟 8 μ s。对比傲腾, 顺序速度落后了 50%、随机读速仅 1/5、延迟也多出 2 μ s。

华为获颁中国首个 5G 无线电通信设备进网许可证 (来源: TechWeb): 10 月 25 日, 今天下午消息, 华为官方微信发文称, 华为获颁中国首个 5G 无线电通信设备进网许可证。近日, 工业和信息化部颁发中国首个 5G 无线电通信设备进网许可证。华为率先获得首张 5G 基站设备的进网许可证, 标志着华为 5G 基站设备可以支持中国规模部署, 正式接入公用电信商用网络。

TCL 三折手机原型机曝光 (来源: TechWeb): 10 月 24 日, 外媒展示了 TCL 的一款三折屏幕手机, 因其处于原型机阶段, 目前规格、价格、销售时间尚不明确。目前, 该手机还没有确切的规格数据, 但该原型机的对角线大约是 10 英寸 (约 25.4 厘米)。大多数目前我们见过的可折叠手机, 比如三星 Galaxy Fold, 都只有一个转轴, 可以对折。但 TCL 的这款手机有两个转轴, 这样屏幕能够从不同方向折叠。

台积电 5nm 情况披露: 良率接近 5 成, 月产 8 万片左右 (来源: 集微网): 早前台积电总裁魏哲家在上周法人说明会中提及, 台积电 5nm 制程已进入风险试产阶段、并有不错的良率表现, 将如原先规划在明年上半年进入量产, 而与目前量产中的 7nm 制程相较, 5nm 芯片密度可大幅提高 80%, 运算速度也可提升 20%。有业内人士透露了台积电 5nm 的情况, 他称目前台积电 5nm 的良率已经接近 5 成, 月产上看 8 万片左右。另外业界关心的苹果 A14 芯片也于 9 月底送样, 虽然苹果不会在意先进制程的高成本问题, 但台积电目前的良率还暂时无法撑起明年的两大核心客户, 相关细节仍要到明年第一季再做评估。

内存价格再跌 16% SK 海力士 Q3 季度净利暴跌 89% (来源: TechWeb): 2019 年 10 月 24 日, 韩国 SK 海力士公司发布了 Q3 季度财报, 当季营收 6.839 万亿韩元, 同比下滑 40%, 环比增长 6%, 净利润 4950 亿韩元, 环比下滑 8%, 同比暴跌 89%。从现在的情况来看, SK 海力士的运营收入相比 Q2 季度在改善, 营收从 6.45 万亿韩元增长 6% 到 6.84 万亿, 但是与去年同期的 11.42 万亿韩元相比依然是暴跌 40%。

三星正式发布 Exynos 990 旗舰处理器 双模 5G (来源: TechWeb): 据 sammobile、anandtech 等报道, 三星公司正式发布 Exynos 990 旗舰处理器。据了解, 三星公司在加利福尼亚州圣何塞举行的 2019 年“三星技术活动”上正式推出了 Exynos 990 处理器, 三星称这是基于 7nm EUV 工艺的旗舰移动处理器。三星 Exynos 990 处理器采用新的 5G 调制解调器, 为 Exynos Modem5123, 支持所有的网络技术 (5G 双模、兼容 2G-4G)。

台积电年底开建 3nm 晶圆工厂 (来源: TechWeb): 在三星上周纸面预览了其 3nm 工艺后, 台积电也毫不示弱, 业内人士称, 台积电年底前会敲定南部科技园的 30 公顷土地 (30 万平方米), 随后启动 3nm 晶圆厂的建设。目前, 台积电的 12 寸超大晶圆厂有六座, 分别是总部及晶圆十二 A 厂、研发中心及十二 B 厂、晶圆十四厂、晶圆十五厂、晶圆十六厂 (南京) 和晶圆十八厂。在 7nm 世代取得大捷后, 台积电在上周的财报会议上表示, 5nm 的进度比 7nm 更顺利, 产能也会提至新高, 关于 3nm 的技术细节, 台积电尚未披露。

华为推出全球首款千元以下商用 5G 工业模组 引爆 5G 万物互联 (来源: TechWeb): 10 月 23 日, 华为在深圳坂田基地举办的“华为 5G 及全场景新品发布会”上, 隆重发布了全球首款商用 5G 工业模组, 首发单片价格 999 元, 是全球首款千元以下的 5G 工业模组, 大大降低了 5G 进入千

行百业的门槛。华为 5G 工业模组，不仅是全球首款商用 5G 工业模组，而且还是首款 5G NSA/SA、单芯全模的 5G 工业模组，核心器件自主可控。

紫光 DRAM 业务传捷报，已成功打入这款智能盒子供应链（来源：集微网）：10 月 23 日，据中央社报道，紫光集团的 DRAM 业务传来捷报，旗下紫光国芯的 DDR3 SDRAM 已经成功打入创维小度 AI 盒子供应链。据了解，创维小度 AI 盒子于今年 1 月的 CES 2019 上推出。这款智能盒子由创维与百度联合开发，搭载百度 DuerOS 系统，同时也可以作为智能音箱使用。拆解报告指出，创维小度 AI 盒子采用了松翰微控制器和瑞昱蓝牙无线网络芯片，另外，还有紫光国芯的 DDR3 SDRAM 和金士顿的嵌入式记忆体（eMMC）也都获创维小度 AI 盒子采用。

16999 元！华为 5G 折叠屏手机 Mate X 发布（来源：TechWeb）：如此前猜测，在今天下午的 5G 终端及全场景新品发布会上，华为正式发布 Mate X，采用可折叠全面屏，支持 5G 双模全网通。事实上，华为 Mate X 于今年 2 月份的 MWC 大展上首发。不过，因为各种问题，延期到今天才最终决定上市，配置上也有所升级。产品形态上，华为 Mate X 闭合时，是主屏 6.6 英寸的折叠手机（背面屏幕为 6.38 英寸），展开后，秒变 8 英寸“平板电脑”，最薄处厚度仅 5.4 毫米。

ARM 正式推出 Mali-G57 GPU（来源：TechWeb）：10 月 23 日消息，芯片设计商 ARM 包揽了当今几乎所有 Android 智能手机中的 CPU 和 GPU 设计，该公司今天刚刚发布了一些针对中端设备的新设计。其中最重要的是 Mali-G57 GPU，这是首个基于该公司新的 Valhall 架构的中端 GPU，这种新架构也为 Mali-G77 旗舰 GPU 所采用。ARM 声称，Mali-G57 的“性能密度”比其先前的中端图形芯片 Mali-G52 GPU 高 1.3 倍。与早期的 GPU 相比，它的能源效率也提高了 1.3 倍。在 VR 中支持集中式渲染，并且机器学习性能提高 60%。

德州仪器三季度营收 37.71 亿美元 营收净利润均不及去年同期（来源：TechWeb）：10 月 23 日消息，半导体设计与制造厂商德州仪器，在今年三季度营收 37.71 亿美元，净利润接近 14.3 亿美元，均不及去年同期。财报显示，其在今年三季度营收 37.71 亿美元，去年同期为 42.61 亿美元，同比下滑 11%；但略高于上一季度的 36.68 亿美元。营业利润方面，财报显示是 15.89 亿美元，较去年三季度的 19.37 亿美元下滑 18%，高于营收的同比下滑幅度；今年二季度为 15.06 亿美元，环比增加 0.83 亿美元。

阿里平头哥正式开源 RISC-V 架构 MCU 芯片平台（来源：摩尔芯闻）：今天，在第六届乌镇互联网大会上，阿里巴巴平头哥官方宣布，正式开源低功耗 MCU 设计平台。这在国内尚属首次，也是平头哥接连发布玄铁 910、无剑 SoC、含光 800 之后的又一壮举。平头哥表示，此次开源的 MCU 芯片平台面向 AIoT 时代的定制化芯片设计需求，目标群体包括芯片设计公司、IP 供应商、高校、科研院所等。

联发科计划在 2020 年为中端机型推出 5G 芯片组（来源：c114）：据报道，联发科正计划生产另一款 7nm 芯片，其价格将更加实惠，并进入中端市场。据 MyDrivers 称，其架构应与 MT6885 相同（即带有 Helio M70 调制解调器的芯片组），但芯片尺寸会更小且成本将降低。预计将于 2020 年第二季度实现量产，这也意味着明年第三季度才会进入市场。联发科完成这两个平台的开发后，预计将转向台积电的 6nm EUV 工艺，这将是联发科的首款 EUV 产品。

三星 S10 指纹识别漏洞引关注 多家金融 APP 关闭指纹登陆功能（来源：TechWeb）：近日，三星 Galaxy S10 等设备的指纹识别安全漏洞问题引发全球关注，尽管三星官方发布声明将发布补丁修复该问题，目前国内外多家金融机构已采取措施，关闭涉及相关机型的指纹登录功能。此前据外媒报道，一对英国夫妇发现，三星 Galaxy S10 手机的指纹识别出现 Bug，在给手机装上网购的硅胶保护壳后，任何人的指纹都能解锁手机，甚至可以登录银行 APP。

46 亿欧元！ams 再向欧司朗提出收购要约（来源：LEDinside）：18 日，欧司朗发布新闻稿宣布 ams 向欧司朗提出了新的收购要约，收购总价从 43 亿欧元升到 46 亿欧元，而这一次，由安宏资本（Advent International）和贝恩资本（Bain Capital）组成的财团将放弃竞购！消息显示，ams 拟向欧司朗股东提交自愿公开收购要约，以每股 41 欧元的价格，总价约 46 亿欧元收购欧司朗所有股权，最低接受门槛为 55%。

长江存储 64 层 3D 闪存年底产能达 6 万片（来源：中国半导体论坛）：据报道，今年一季度，紫

光旗下的长江存储(YMTC)开始投产64层堆栈3D闪存,容量256Gb,TLC芯片,初期的月产能仅有5000片。最新消息称,长江存储的64层3D闪存芯片将在年底前将月产能提高到6万片。

SK海力士开发第三代1Znm内存芯片(来源:IT之家):据TechWeb报道,10月21日,SK海力士宣布开发适用第三代1Z纳米DDR4 DRAM,并且,SK海力士表示,第三代1Z纳米DDR4 DRAM计划今年完成批量生产,从明年开始正式供应。

先进微电子收购以色列封测设备公司ADT,耗资3700万美元(来源:今日芯闻):近日,光力科技发布公告称,光力科技通过全资子公司郑州光力瑞弘电子科技有限公司参股了先进微电子装备(郑州)有限公司,先进微电子以其全资子公司上海能扬新能源科技有限公司收购以色列ADT公司100%股权,交易对价为3700万美元。

工信部:三大运营商在全国开通5G基站8.6万个(来源:TechWeb):在第六届世界互联网大会上,工信部副部长陈肇雄表示,目前,中国电信、中国移动、中国联通在全国开通5G基站8.6万个,北京、上海、广州、杭州等城市,实现5G网络连片覆盖,预计年底,全国开通5G基站超过13万个。当前,北京5G产业建设领跑全国,数据显示,预计到今年年底,北京5G基站将超过1.5万个。

三星本月追加折叠手机订单10.2万台,明年供应链或起飞(来源:集微网):三星首款折叠手机Galaxy Fold 9月在韩国重新上市,预售10分钟全部抢购一空,市场反应火热,令三星决定重启折叠面板生产,三星10月正式追加10.2万台折叠手机订单,对此,全球第4大PI薄膜供应商达迈董事长吴声昌看好折叠手机趋势,明年有机会进一步发酵,中国大陆一线品牌将全面推出折叠手机,达迈相关技术已准备好了,就等市场起飞。

加速国内5G手机普及三星中端新机Galaxy A905G发布 售价4499元(来源:TechWeb):10月18日,三星在上海举办Galaxy A90 5G媒体沟通会,会上正式发布了三星中端5G手机Galaxy A90 5G闪电侠。三星Galaxy A90 5G搭载了成熟的5G网络,采用4800万超高像素后置三摄组合、6.7英寸(直角)绚丽U视屏,以及骁龙855处理器和4500mAh(典型值)电池等配置,为年轻用户带来旗舰级使用体验。

台积电Q3营收679亿元 同比增长12.6%(来源:TechWeb):据国外媒体报道,今日,半导体制造商台积电公布了截至2019年9月30日的第三季度财报。财报显示,该公司2019年第三季度的综合营收为新台币2930.5亿元(约合679亿元人民币),同比增长12.6%,净收入为新台币1010.7亿元(约合234亿元人民币),同比增长13.5%。

与台积电争晶圆代工头牌,三星向ASML订购15台EUV设备(来源:集微网):近日,根据可靠消息,半导体行业巨头三星正考虑对其在中国西安兴建的二期半导体工厂进行额外投资,据透露,三星计划明年将存储器芯片设施的资本支出小幅增加至65亿美元。有消息称,三星西安二期工厂已安装部分设备并开始试运行,以检查量产前的情况,预计将在2020年2月开始批量生产。

OPPO将在年前首发高通双模5G手机(来源:TechWeb):10月16日,OPPO首席5G科学家唐海出席高通5G峰会,在5G专题论坛会上,唐海表示,OPPO将在年底前首发全球搭载高通双模5G芯片的手机,该5G手机将同时支持SA和NSA。在当前,5G手机有待进一步普及,OPPO希望能够通过新一代双模5G产品更好的满足当下的消费者,推进5G在全球的普及。

继CEO离职后,长电科技再迎重大人事变动(来源:今日芯闻):10月17日,据长电科技发布公告称,根据长电科技首席执行官(CEO)郑力先生提名,董事会一致同意改聘穆浩平先生为公司资金营运资深副总裁,不再担任首席财务长;同时,聘任周涛女士为公司首席财务长。长电科技此前公布的半年度报告显示,今年上半年公司共实现营收91.48亿元,同比下降19.06%,归属于上市公司股东净利润为-2.9亿元。

华为发布前三季度经营业绩:销售收入6108亿元 智能手机出货1.85亿部(来源:TechWeb):华为今天对外发布2019年三季度经营业绩,数据显示,截至2019年第三季度,公司实现销售收入6108亿人民币,净利润率8.7%。具体来看,消费者业务方面,华为前三季度发货量超过

1.85 亿台，同比增长 26%；PC、平板、智能穿戴、智能音频等新业务获得高速增长。华为终端云服务（Huawei Mobile Services，即 HMS）生态获得迅速发展，已覆盖全球 170 多个国家和地区，全球注册开发者超过 107 万。

华为海思向公开市场推出首款 4G 通信芯片 Balong 711（来源：TechWeb）：10 月 16 日消息，华为海思宣布向物联网行业推出首款华为海思 LTE Cat4 平台 Balong 711。这款芯片自 2014 年发布以来承载了海量发货应用，支持 LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/GSM 多模制式，为物联网行业客户提供解决方案。据介绍，Balong 711 套片包含三颗芯片：基带芯片 Hi2152、射频芯片 Hi6361、电源管理芯片 Hi6559，平台目前已大量应用于各行各业，全球累计出货量约 1 亿套。

三星西安半导体二期工厂或将明年正式投产（来源：SEMICChina）：近日，根据可靠消息，半导体行业巨头三星正考虑对其在中国西安兴建的二期半导体工厂进行额外投资，据透露，三星计划明年将存储器芯片设施的资本支出小幅增加至 65 亿美元。有消息称，三星西安二期工厂已安装部分设备并开始试运行，以检查量产前的情况，预计将在 2020 年 2 月开始批量生产。

StrategyAnalytics：2019 年 Q2 高通以 43% 份额保持全球基带市场领先（来源：TechWeb）：日前，Strategy Analytics 手机元件技术研究服务发布研究报告《2019 年 Q2 基带市场份额追踪：高通和三星争夺 5G 基带市场领导权》。Strategy Analytics 的报告指出，2019 年 Q2 全球蜂窝基带处理器市场收益年同比下降 4%，为 50 亿美元。2019 年 Q2 全球蜂窝基带处理器市场收益份额位居前五名的为：高通、海思半导体、联发科、三星 LSI 和英特尔。2019 年 Q2 高通以 43% 的收益份额保持全球基带市场领先，海思半导体以 15% 的收益份额排名第二，联发科以 14% 紧随其后。

Oppo 全新专利：瀑布屏+屏下指纹识别/摄像头（来源：c114）：据 Oppo 最近申请的专利表明，未来的瀑布屏可能呈现四边弯曲的状态。对此，oppo 申请了屏下摄像头的专利。据报道，在该专利中，oppo 将一个光传感器和另一个红外光传感器放于屏下。这样就无需使用边框来放置传感器，一个边框用于调整亮度以适应环境光，而另一个边框则可以在通话中关闭显示屏。该技术可以用于 Micro LED 或 OLED 显示屏。

一加 7T 系列正式发布 全系标配 90Hz 流体屏（来源：旭日大数据）：10 月 15 日，一加在北京工业大学正式发布了一加 7T 系列新品，一加 7T、一加 7T Pro 和一加 7T Pro 迈凯伦限定版在发布会现场一齐亮相。一加 7T 系列将于 10 月 15 日下午 6 点在一加官网及京东开启预售。一加 7T 全系搭载独家定制的 90Hz 流体屏，正式完成全产品线向 90Hz 高刷新率屏幕的切换。

LG 宣布成功替代日本进口氟化氢，100% 韩国产（来源：摩尔芯闻）：由于日韩两国之间的贸易纠纷，日本政府 7 月初决定禁止三种重要半导体、显示面板材料出口给韩国，迫使韩国公司走上独立自主的道路。LG 公司日前证实，旗下面板工厂已经完成使用国产氟化氢材料取代日本进口，100% 韩国产。

台积电 16nm 产能不足，制程交期拉长一倍（来源：今日芯闻）：据 TechWeb 10 月 15 日报道，近日，台积电发布公告表示，由于全球各大厂商持续下单，台积电 2019 年第三季度先进制程面临产能紧缺的压力。目前，台积电 16nm 制程交期拉长一倍。

高通骁龙 X55 已被全球 30 多家 OEM 厂商采用（来源：今日芯闻）：据 TechWeb 报道，10 月 14 日，高通宣布骁龙 X55 5G 调制解调器及射频系统已被全球超过 30 家 OEM 厂商采用，支持商用 5G 固定无线接入（FWA）CPE 终端将从 2020 年开始发布。据悉，骁龙 X55 调制解调器，最主要的特点就是覆盖 5G 到 2G 多模全部主要频段，支持独立（SA）和非独立（NSA）组网模式，另外 X55 还是全球首款实现 7Gbps 速率的 5G 调制解调器，此前 X50 仅支持最高 5Gbps 下载速率。

英特尔第一颗 8 线程酷睿 i3 亮相（来源：今日芯闻）：据驱动之家 10 月 14 日报道，基准测试软件 SiSoft Sandra 的数据显示，英特尔 10 代酷睿桌面处理器 i3-10100 配置为 4 核 8 线程，这将是第一颗 4 核多线程的 Core i3 处理器。并且，英特尔 10 代 Comet Lake 采用了 14nm 工艺。

2019 年 9 月国内上市 5G 新机 9 部 5G 手机出货量 49.7 万部（来源：集微网）：根据中国信通院公布的数据显示，2019 年 9 月，国内手机市场总体出货量 3623.6 万部，其中 2G 手机 145.4

万部、4G手机 3428.6 万部、5G手机 49.7 万部。上市新机型 90 款，其中 2G手机 22 款、4G手机 59 款、5G手机 9 款。同时 2019 年 1-9 月，5G手机共上市 18 款。

因售价太贵，苹果砍掉约 10%的 iPhone 11 Pro Max 订单（来源：集微网）：据钛媒体消息，产业链给出的最新内幕显示，苹果对 iPhone 11 Pro Max 这款型号的订单进行了调整，整体来说就是在之前的基础上下调了约 10%左右，主要原因是价格太贵，用户换新动力不足，而之前追加的 iPhone 11 系列订单中，并不包含 iPhone 11 Pro Max。

任正非：鸿蒙系统两三年内可媲美苹果（来源：今日芯闻）：据新华社 10 月 10 日报道，华为心声社区发布了 9 月 19 日华为创始人任正非接受美国《财富》杂志的采访纪要。任正非表示，鸿蒙两三年内可以媲美苹果系统，并且坚持与 Google 友好合作。

三星电子：将投资 110 亿美元开发下一代显示器产品（来源：SEMICChina）：三星显示器公司计划投资 13.1 万亿韩元（约 110 亿美元），用于开发和制造下一代显示器产品，以此来应对来自中国竞争对手的供应和价格压力。该公司在一份声明中表示，他们将在峨山建立一条量子点显示器生产线，并将于 2021 年开始投产，初期年产能为 3 万块大于 65 英寸的面板。之后产能将会有所提升，该公司还制定了一个截止到 2025 年的长期发展计划。

苹果计划 2022 年发布自研调制解调器 2023 年将基带整合到 SoC（来源：TechWeb）：援引外媒 Fast Company 报道称，苹果内部团队已经设定了一项非常激进的目标：在 2022 年开发出能够在 iPhone 和 iPad 上使用的内嵌蜂窝通信调制解调器；在 2023 年前将基带模组整合到公司的 system-on-chip（SoC）设计中。

全球 PC 出货量同比增长 1.1%：联想扩大领先惠普优势（来源：TechWeb）：据市场研究公司 Gartner 的一份报告显示，在截至 9 月 30 日的第三季度，全球 PC 出货量攀升至 6800 万台。联想在全球市场中占有近 25% 的份额，扩大了其较之于美国竞争对手惠普公司的领先地位。紧随联想、惠普和戴尔之后的是苹果。苹果在美国的出货量同比增长了 3%，这使得它和惠普的增长速度快于市场平均水平。

工信部：1-8 月我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长 8.5%（来源：今日芯闻）：工信部 10 月 9 日发的数据显示，2019 年 8 月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 4.7%，1-8 月份增加值同比增长 8.5%。2019 年 8 月，规模以上电子信息制造业出口交货值同比下降 4.6%，1-8 月份，实现出口交货值同比增长 2.8%。从具体分布行业来看，2019 年 8 月，通信设备制造业增加值同比下降 2.7%，电子元件及电子专用材料制造业增加值同比增长 14.3%，计算机制造业增加值同比增长 3.9%，电子器件制造业增加值同比增长 4.8%，主要产品中，集成电路产量同比增长 0.2%。

OPPO Reno Ace 正式发布 售价 3199 元起（来源：TechWeb）：今天，OPPO 正式发布了 OPPO Reno Ace 手机，这款手机共有三个版本，分别是 8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB，售价分别为 3199 元、3399 元、3799 元。OPPO Reno Ace 手机采用了高通骁龙 855 Plus 芯片，支持 OPPO 全新的 65W SuperVOOC 超级闪充，同时还有一块 90Hz 刷新率的电竞屏。

徐国晋新任台湾美光董事长 曾担任台积电 WaferTech 总经理（来源：今日芯闻）：美光 10 月 9 日宣布，任命徐国晋为美光企业副总裁暨中国台湾美光董事长，未来负责管理美光在中国台湾的 3 家子公司，包括中国台湾美光存储器、中国台湾美光晶圆及中国台湾美光半导体，同时领导美光高量产的 DRAM 卓越中心，致力在人工智能、机器学习等新兴存储器应用领域寻求突破。

工信部：推进设立集成电路一级学科，持续推进半导体相关产业发展（来源：集微网）：据工信部官网消息，对于民进 9 组提出的《关于加快支持工业半导体芯片技术研发及产业化自主发展的提案》，工信部表示近年来，我国集成电路产业发展取得了长足进步，但是核心技术受制于人的局面仍然没有根本改变，急需加强核心技术攻关，保障供应链安全和产业安全。工信部进一步表示，下一步，我部及相关部门将持续推进工业半导体材料、芯片、器件及 IGBT 模块产业发展，根据产业发展形势，调整完善政策实施细则，更好的支持产业发展。对于人才问题，工信部将与教育部等部门进一步加强人才队伍建设。推进设立集成电路一级学科，进一步做实做强示范性微电子学院，加快建设集成电路产教融合协同育人平台，保障我国在工业半导体材料、芯片、器件

及 IGBT 模块产业的可持续发展。

Qorvo 宣布已收购 Cavendish Kinetics (来源: 今日芯闻): 据射频解决方案供应商 Qorvo 官网 10 月 9 日宣布, Qorvo 已收购全球领先的高性能射频供应商 Cavendish Kinetics。Qorvo 移动产品部总裁 Eric Creviston 表示, 收购 Cavendish Kinetics 能巩固 Qorvo 在天线调谐方面的市场领导地位。并且, Qorvo 将在原有的基础上进行优化和扩展, 并将其应用于基础设施和国防等其他应用。

受华为麒麟 990 冲击 高通骁龙 865 或提前至 11 月发布 (来源: TechWeb): 数码闲聊站爆料称, 受华为最新旗舰芯片麒麟 990 系列的冲击, 高通的骁龙 865 芯片很可能会提前到 11 月发布, 包括三星、OPPO、vivo、小米等头部厂商也会展示基于样片试产的骁龙 865+骁龙 X55 基带的高性能 5G 手机。

美国制裁 28 家中国机构 海康威视等强烈反对 (来源: 今日芯闻): 据新浪科技 10 月 8 日报道, 美国商务部将包括海康威视、大华科技、科大讯飞、旷视科技、商汤科技、美亚柏科、溢鑫科技和依图科技等在内的 28 家中国机构、公司列入美国出口管制“实体名单”(又称黑名单), 限制这些机构和公司从美国购买零部件。海康威视高级副总裁、董秘黄方红回应称, 海康威视强烈反对美国商务部把公司纳入“实体清单”, 这个决定没有事实根据, 呼吁美国政府本着公平、公正、无歧视的原则, 重新进行审视, 将海康威视移出实体清单。

台积电: 6 纳米制程技术明年第一季度试 (来源: 今日芯闻): 据 TechWeb 报道, 台积电在 10 月 7 日透露, 该公司 6 纳米制程技术 (N6) 将于 2020 年第一季度进入试产, 并于年底前量产。台积电称, 其极紫外光 (EUV) 微影技术之 7 纳米强效版 (N7+) 制程已协助客户产品大量进入市场。导入 EUV 微影技术的 N7+ 奠基于该公司成功的 7 纳米制程之上, 为 6 纳米和更先进制程奠定良好基础。随著 EUV 微影技术的进一步应用, N6 的逻辑密度将比 N7 提高 18%, 而 N6 凭借与 N7 完全相容的设计法则, 也可大幅缩短客户产品上市的时间。

三星率先开发出 12 层 3D 硅穿孔堆叠: HBM 存储芯片容量提至 24GB (来源: SEMIChina): 近日, 三星电子宣布率先在业内开发出 12 层 3D-TSV(硅穿孔)技术。三星称, 他们得以将 12 片 DRAM 芯片通过 60000 个 TSV 孔连接, 每一层的厚度仅有头发丝的 1/20。总的封装厚度为 720 μ m, 与当前 8 层堆叠的 HBM2 存储芯片相同, 体现了极大的技术进步。

英特尔推出全新 W-2200 Xeon 芯片 (来源: 今日芯闻): 据 TechWeb 消息, 10 月 8 日, 英特尔发布了全新的 W-2200 Cascade Lake-X Xeon 芯片, 该芯片将适用于苹果即将推出的最新款 iMac Pro 产品。全新 W-2200 芯片拥有最多 18 颗 AVX 512 的内核, 以及多达 48 个 PCIe 通道, Turbo Boost Max 3.0 和 AI 加速 (英特尔的深度学习 Boost 功能), 可用于视觉效果, 动态图形, 3D 渲染等工作。

美光拿出第一批第 4 代 3D NAND 芯片样品 (来源: SEMIChina): 美光科技已经流片第一批第四代 3D NAND 存储芯片, 它们基于美光全新的 RG 架构。该公司有望在 2020 年生产商用第四代 3D NAND 内存, 但美光警告称, 使用新架构的存储芯片将仅用于特定应用, 因此明年其 3D NAND 成本削减将微乎其微。

全球第三大芯片制造商 GlobalFoundries 透露上市计划 或在 2022 年 (来源: TechWeb): 近日, 世界第二大晶圆制造商 GlobalFoundries 向媒体透露了其上市计划, 公司 CEO Thomas Caulfield 在采访中表示, 最快在 2022 年上市。但是 GlobalFoundries 想要公开上市, 则还有很长的路要走。为了成功进行首次公开募股, GlobalFoundries 必须成为一家持续盈利的公司。

三星电子最后一家中国手机厂已于 9 月底停工 (来源: TechWeb): 10 月 3 日, 外媒消息, 韩国三星电子周三表示, 已经在 9 月底暂停中国手机工厂的生产。三星电子所说在华最后一座手机工厂位于广东惠州。

"没有中间商赚差价"! TI 连砍 3 家代理商! (来源: 中国半导体论坛): 近日, TI 刚刚宣布取消全球第二大代理商安富利的代理权后, 业内还在消化这一新闻带来的震动时, 今天又爆出 TI 将拿掉大联大旗下世平兴业和文晔的代理权! TI 直销决心之大之快惊诧众人。至此, TI 代理商仅剩 Arrow 一家。

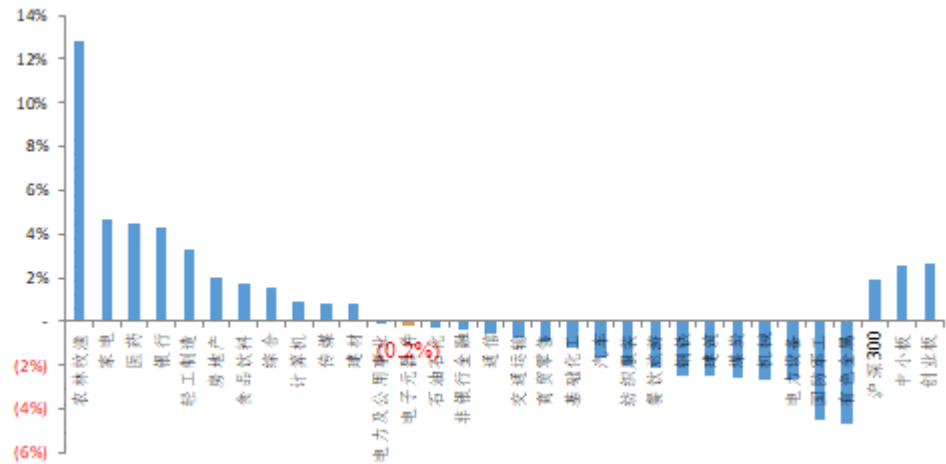
三、市场走势分析

上月电子元器件行业一级指数下跌 0.2%，跑输沪深 300 指数 2.1 个百分点，在 29 个一级指数中位列第 13 位，排名中等。海外市场方面，香港资讯科技指数、美国费城半导体指数和台湾资讯科技指数均上涨，其中美国和台湾走势强于市场。上月香港恒生资讯科技指数上涨 1.1%，跑输恒生指数 2.0 个百分点；费城半导体指数上涨 5.9%，跑赢标普 500 指数 3.9 个百分点；台湾资讯科技指数上涨 8.6%，跑赢加权指数 3.7 个百分点。

(一) 国内 A 股市场走势分析

上月电子元器件行业一级指数下跌 0.2%，在 29 个一级指数中位列第 13 位，排名中等。

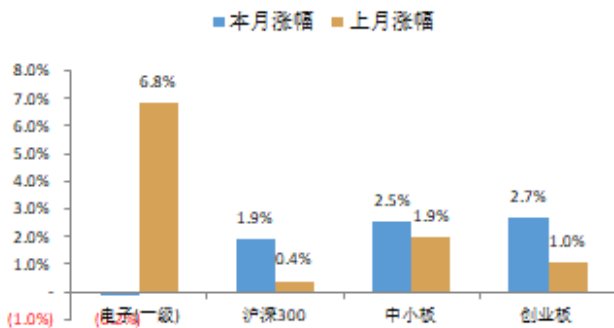
图 28: 中信行业一级指数涨跌幅



资料来源: Wind, 华金证券研究所

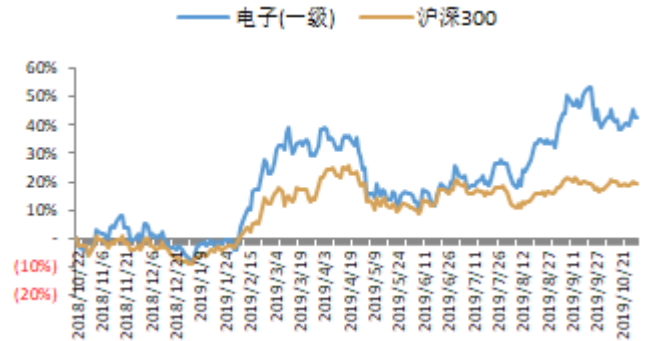
上月电子元器件行业一级指数下跌 0.2%，分别跑输沪深 300 指数、中小板指数和创业板指数 2.1、2.7 和 2.9 个百分点。

图 29: 电子一级指数 v.s.市场整体指数



资料来源: Wind, 华金证券研究所

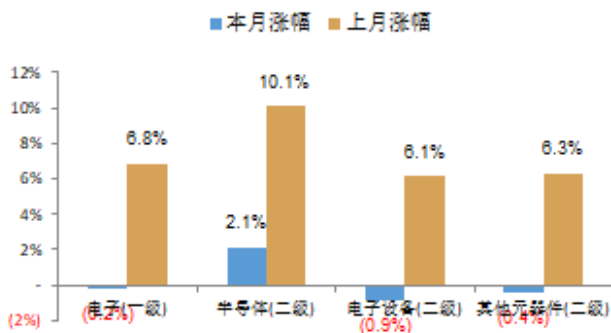
图 30: 电子一级指数 v.s.沪深 300 指数



资料来源: Wind, 华金证券研究所

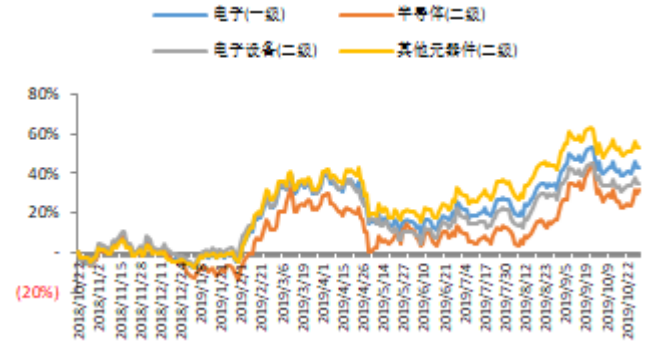
过往 250 个交易日累计涨幅，电子元器件行业一级指数上涨 43.0%，走势强于沪深 300 指数 19.0%的涨幅，整体走势反弹且强于市场。电子行业二级指数方面，半导体行业上涨 2.1%、电子设备和其它元器件行业则分别下跌 0.9%和 0.4%。

图 31: 电子二级指数 v.s. 电子一级指数



资料来源: Wind, 华金证券研究所

图 32: 电子二级指数 v.s. 电子一级指数



资料来源: Wind, 华金证券研究所

从行业个股涨幅情况看, 本月行业个股下跌情况较多, 涨幅前三位分别为星星科技(300256)、麦捷科技(300319)和漫步者(002351), 涨幅榜后三位分别为三盛教育(300282)、退市大控(600747)和睿能科技(603933)。

表 2: 电子元器件行业个股涨跌幅榜

代码	公司名称	涨幅	所属二级行业	代码	公司名称	涨幅	所属二级行业
涨幅前十				跌幅前十			
300256	星星科技	51.7%	其他元器件II	000413	东旭光电	(16.0%)	其他元器件II
300319	麦捷科技	37.4%	其他元器件II	300787	海能实业	(17.5%)	其他元器件II
002351	漫步者	37.2%	电子设备II	300776	帝尔激光	(17.8%)	电子设备II
002045	国光电器	33.9%	电子设备II	002947	恒铭达	(18.5%)	其他元器件II
300613	富瀚微	32.6%	半导体II	002902	铭普光磁	(20.6%)	电子设备II
002655	共达电声	30.4%	电子设备II	002962	五方光电	(24.9%)	其他元器件II
300433	蓝思科技	28.2%	其他元器件II	002052	同洲电子	(24.9%)	电子设备II
300007	汉威科技	27.8%	电子设备II	603933	睿能科技	(31.4%)	电子设备II
300661	圣邦股份	26.5%	半导体II	600747	退市大控	(34.4%)	其他元器件II
002861	瀛通通讯	24.5%	其他元器件II	300282	三盛教育	(36.2%)	其他元器件II

资料来源: Wind, 华金证券研究所

从涨跌幅榜分布看, 二级行业中电子设备和其他元器件行业涨跌幅均较大。

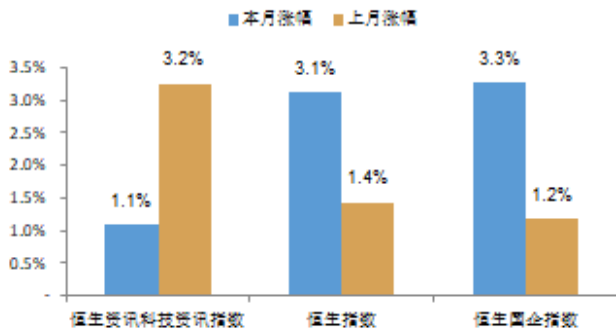
(二) 海外市场走势分析

海外市场方面, 香港资讯科技指数、美国费城半导体指数和台湾资讯科技指数均上涨, 其中美国和台湾走势强于市场。上月香港恒生资讯科技指数上涨 1.1%, 跑输恒生指数 2.0 个百分点; 费城半导体指数上涨 5.9%, 跑赢标普 500 指数 3.9 个百分点; 台湾资讯科技指数上涨 8.6%, 跑赢加权指数 3.7 个百分点。

1、香港

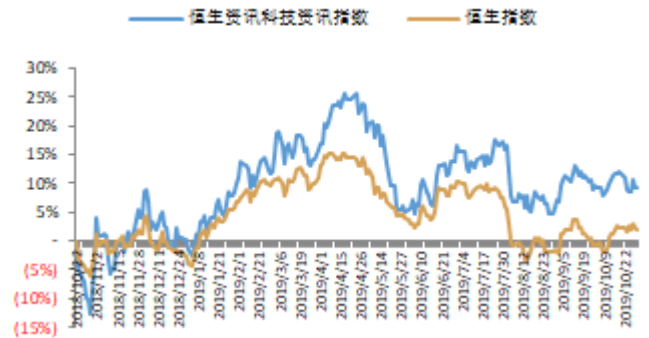
上月香港恒生资讯科技指数上涨 1.1%, 分别跑输恒生指数和恒生国企指数 2.0 和 2.2 个百分点, 行业走势弱于市场整体。

图 33: 恒生资讯科技指数 v.s. 市场指数



资料来源: Wind, 华金证券研究所

图 34: 恒生资讯科技指数 v.s. 恒生指数



资料来源: Wind, 华金证券研究所

过往 250 个交易日的累计涨幅看, 恒生资讯科技指数为上涨 9.2%, 涨幅高于恒生指数的 2.0%, 港股科技板块走势强于市场。

表 3: 香港资讯科技行业个股涨跌幅榜

代码	公司名称	涨幅	代码	公司名称	涨幅
涨幅前五			跌幅前五		
2018	瑞声科技	22.9%	1357	美图公司	(3.3%)
3690	美团点评-W	16.9%	0732	信利国际	(6.4%)
2038	富智康集团	16.7%	0885	仁天科技控股	(6.7%)
0698	通达集团	16.4%	0400	科通芯城	(7.8%)
0241	阿里健康	15.5%	2280	慧聪集团	(14.5%)

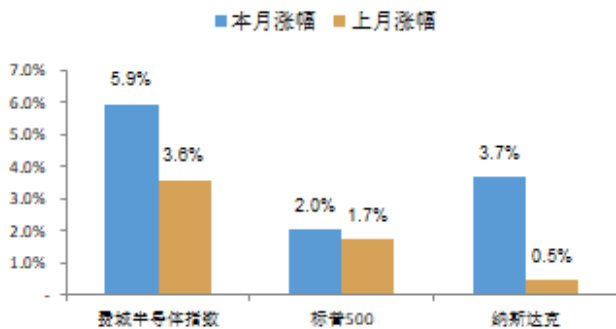
资料来源: Wind, 华金证券研究所

从行业指数成分股涨幅情况看, 上月涨幅前三位分别为瑞声科技(2018)、美团点评-W(3690)和富智康集团(2038)。跌幅榜前三位分别为慧聪集团(2280)、科通芯城(0400)和仁天科技控股(0885)。

2、北美

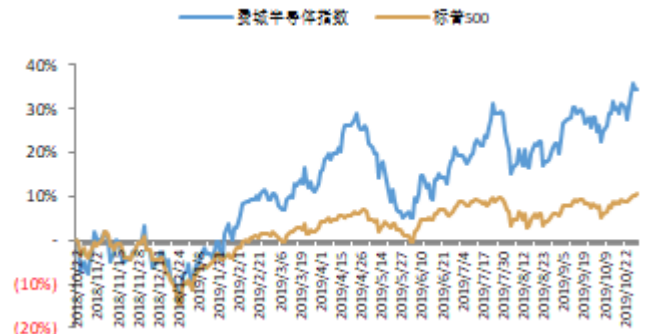
上月费城半导体指数上涨 5.9%, 分别跑赢标普 500 指数和纳斯达克指数 3.9 个百分点和 2.2 个百分点, 行业市场指数走势强于市场整体。

图 35: 费城半导体指数 v.s. 市场指数



资料来源: Wind, 华金证券研究所

图 36: 费城半导体指数 v.s. 标普 500 指数



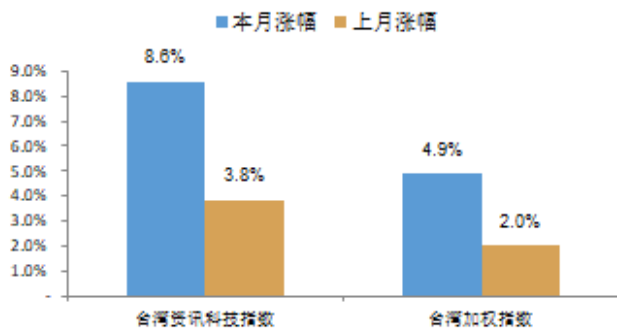
资料来源: Wind, 华金证券研究所

过往 250 个交易日累计涨幅，费城半导体指数累计上涨 34.6%，高于标普 500 指数 10.6% 的涨幅，行业走势显著强于市场。

3、台湾

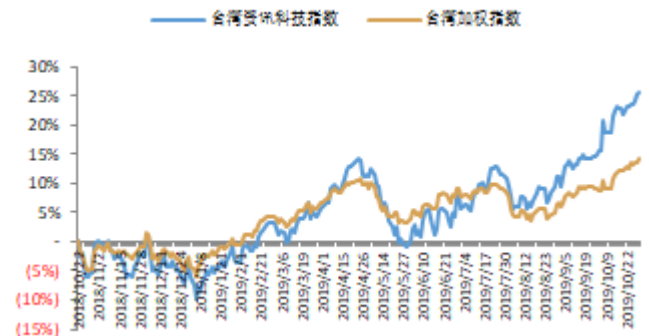
上月台湾资讯科技指数上涨 8.6%，跑赢加权指数 3.7 个百分点，行业指数显著强于大市。

图 37：台湾资讯科技指数 v.s. 台湾加权指数



资料来源：Wind，华金证券研究所

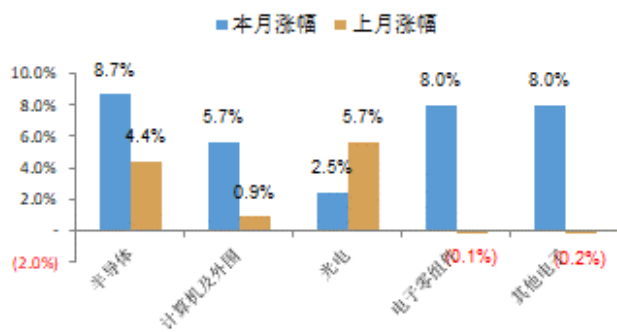
图 38：台湾资讯科技指数 v.s. 台湾加权指数



资料来源：Wind，华金证券研究所

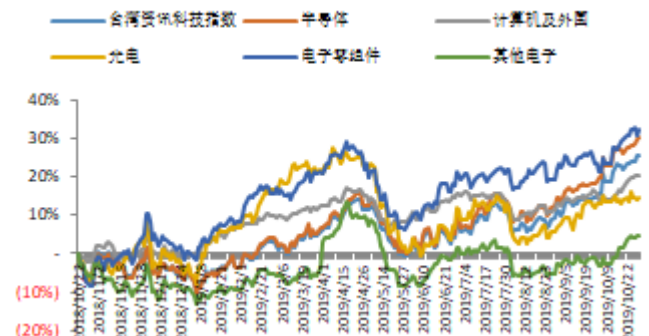
过往 250 个交易日累计涨幅，资讯科技指数上涨 25.6%，强于台湾加权指数 14.1% 的涨幅。

图 39：台湾资讯行业子版块指数



资料来源：Wind，华金证券研究所

图 40：台湾资讯行业子版块指数 v.s. 资讯行业指数



资料来源：Wind，华金证券研究所

从子行业指数方面看，子行业普遍上涨，半导体、计算机及外围、光电、电子零组件和其他电子行业分别上涨 8.7%、5.7%、2.5%、8.0% 和 8.0%。

四、投资建议及个股动态

10月国内A股市场电子元器件行业下跌0.2%，跑输沪深300指数、中小板指数和创业板指数，细分二级行业来看，半导体行业上涨，而其他两个子行业有所下跌。10月是各大厂商密集发布智能终端产品后的市场验证期，从目前看出出货量尚能够维持相对较高的情绪。更为重要的是，三季报整体披露完成后，行业数据整体见底，半导体触底反弹的数据为前期高涨的主题投资热情带来了一定程度上的支持。

未来，短期来看随着业绩披露的结束，并且三季度数据改善，市场对于明年发展趋势和创新方向有了更多的憧憬，带来的主题投资热情有望再次开始，从终端看智能可穿戴设备包括耳机、手表等的关注度高于智能手机，我们认为核心供应链龙头企业受益机会较好。芯片国产化主题中，国产化需求带来的设计厂商Q3业绩改善有望持续到Q4，但之后仍然面临挑战，代工厂和封测厂则是相对更为可靠的受益方。终端应用中，包括智能家居，LED广告显示，智慧城市安防监控则维持了稳定的推进。策略方面我们与季度策略保持一致，行业触底反弹Q4延续惯性仍然存在，同时我们认为市场情绪高涨与公司行业需求不确定性仍然存在矛盾，行业竞争格局的不确定性仍然很大，波动风险显著加剧，市场预期显著提升的情况下，风险也在持续累积，建议保持谨慎，我们同季度策略保持一致，将评级上调至“领先大市-B”。

基于对于行业状况的判断和整体投资建议看，我们建议关注的子版块以接近终端需求为主，包括智能终端供应链，安防等，半导体短期仍然建议观望为主，个股方面，主要推荐标的包括立讯精密（002475）、长盈精密（300115）、莱宝高科（002106）、海康威视（002415）和江海股份（002484）。

表 4：电子元器件行业个股投资建议列表

代码	名称	市值（亿元）	PE（2018）	PE（2019E）	PE（2020E）	PB
002475.SZ	立讯精密	1,702	62	47	34	9.29
300115.SZ	长盈精密	135	350	29	23	3.06
002106.SZ	莱宝高科	57	25	22	18	1.43
002415.SZ	海康威视	3,023	27	22	19	7.48
002484.SZ	江海股份	52	21	20	17	1.55

资料来源：Wind，华金证券研究所（截止2019年10月31日收盘）

另外，我们建议关注标的包括通富微电（002156）、华天科技（002185）、太极实业（600667）、东软载波（300183）、全志科技（300458）、东软载波（300183）、富瀚微（300613）、博通集成（603068）、欧菲光（002456）、安洁科技（002635）、蓝思科技（300433）、科森科技（603626）、深天马A（000050）、环旭电子（601231）、奥拓电子（002587）、洲明科技（300232）等。

1、立讯精密（002475）

近期动态及最新财务数据:

公司发布 2019 年三季报，前三季度销售收入同比增长 71.0%为 378.4 亿元，归属于上市公司股东的净利润同比增长 74.3%为 28.9 亿元，基本 eps 同比增长 74.2%为 0.54 元。

公司发布 2019 年半年报，上半年销售收入同比上升 78.3%为 214.4 亿元人民币，归属上市公司股东净利润同比上升 81.8%为 15.0 亿元人民币，基本 eps 同比上升 79.6%为 0.36 元。

核心投资观点:

1) **传统业务规模增加:** 在无线充电、智能可穿戴设备的产业快速发展和应用渗透的过程中，公司作为核心供应商有望充分受益于产业链市场规模增加的预期，

2) **新兴业务拓展顺利:** 1) 公司通过自身的研发和供应链合作开拓进入了 5G 核心设备厂商的供应链体系，为公司未来的发展打下坚实基础；2) 汽车电子在智能化需求的推进下，也有望为公司的产品升级和产业定位升级提供机遇。

风险提示：核心客户的消费电子终端产品出货量不及预期；通讯市场的核心客户拓展不及预期；产品创新和生产经营落地速度不及预期，影响公司盈利能力。

2、长盈精密（300115）

公司发布 2019 年三季报，前三季度销售收入同比增长 2.8%为 61.8 亿元，归属于上市公司股东的净利润同比增长 6.3%为 1.9 亿元，基本 eps 同比增长 7.1%为 0.2086 元。

公司发布 2019 年半年报，上半年销售收入同比上升 9.3%为 39.6 亿元人民币，归属上市公司股东净利润同比上升 31.2%为 1.2 亿元人民币，基本 eps 同比上升 32.1%为 0.13 元。

核心投资观点:

1) **金属外观件进入海外一线厂商智能终端供应链:** 公司在智能手机和笔记本电脑分别进入全球一线的三星、苹果供应链体系，逐步实现从国内厂商到海外厂商在产品和订单规模上的有效潜移，一方面有利于公司提升品牌形象，另一方面也能够提升公司的风险控制能力。

2) **智能制造业务成长可观:** 公司通过与安川合作成立基于机器人的智能制造子版块，通过对于制造业中自动化改造的机会，获得可靠的订单需求和业务落地，未来在制造业改造升级的过程中对于公司业务成长将会带来有效的新的成长机会。

3) **新能源汽车市场拓展持续:** 1) 公司新能源汽车电池结构件进入国内一线电池厂商，未来产能和订单成长空间广阔；2) 连接器结构件产品进入全球一线新能源汽车厂商供应链，随着终端扩张后公司的订单也有望快速提升。

风险提示：智能手机等产品市场出货量不及预期；精密结构件的市场竞争加剧影响公司盈利能力；公司机器人、新能源汽车等业务规模拓展不及预期。

3、莱宝高科（002106）

近期动态及最新财务数据:

公司发布 2019 年三季报，前三季度销售收入同比增长 8.8%为 34.3 亿元，归属于上市公司股东的净利润同比增长 32.5%为 2.3 亿元，基本 eps 同比增长 32.5%为 0.3237 元。

公司发布 2019 年半年报，上半年销售收入同比上升 12.1%为 21.9 亿元人民币，归属上市公司股东净利润同比上升 72.6%为 0.95 亿元人民币，基本 eps 同比上升 72.6%为 0.14 元。

核心投资观点:

1) **中大尺寸触控显示稳定供货笔记本电脑核心厂商:** 公司在中大尺寸笔记本电脑的触控显示屏中已经与全球核心供应商均建立了良好的合作关系，并且已经实现稳定供货，而且公司重庆生产基地也在产能规模和良率保障方面有了较为显著的效率，因此能够给予公司稳定的业绩贡献。

2) **智能终端厂商入局高端笔记本电脑带来新的需求预期:** 包括华为、小米等传统的智能手机终端厂商开始进入到笔记本电脑市场，并且均推出相关高端触控类产品，公司在相关客户中均以获得较好的认可和可靠的订单，未来可能为公司提供新的需求订单来源。

3) **玻璃镀膜技术的衍生空间较为理想:** 公司核心技术为玻璃等基本材料方面的镀膜能力，未来在电子标签、变色玻璃、柔性镀膜等领域有着良好的技术储备和应用前景，产品不仅在智能终端厂商，还在零售、交通、工业等领域有着较为理想的应用空间。

风险提示：中大尺寸市场需求不及预期；产品良率不及预期或者产能扩张速度不及预期；汇率波动影响。

4、海康威视（002415）

近期动态及最新财务数据:

公司发布 2019 年三季报，前三季度销售收入同比增长 17.9%为 398.4 亿元，归属于上市公司股东的净利润同比增长 8.5%为 80.3 亿元，基本 eps 同比增长 6.7%为 0.86 元。

公司发布 2019 年半年报，上半年销售收入同比上升 14.6%为 239.2 亿元人民币，归属上市公司股东净利润同比上升 1.67%为 42.2 亿元人民币，基本 eps 同比下降 1.11%为 0.444 元。

核心投资观点:

1) **国内市场层面:** 国内安防市场主要由政府投资驱动，我们预计一方面作为基础设施相关的安防视频监控需求在地方政府财政支出有望增加的情况下，将会获得有效的订单推动，另一方面包括国有企业在内的大型企业在增加高水平的 AI 功能的监控下，能够有效替代人力实现安全生产等需求，因此驱动力也来源于市场层面。

2) 海外市场层面: 尽管收到了来自美国、加拿大、澳大利亚等海外政府对于信息安全的质疑,但是由于安防监控的充分本地化以及公司的积极努力下,我们公司在海外民用市场继续维持现有稳健拓展的局面。

3) 泛安防市场的发展: 在传统安防视频监控在公安、交通、金融、司法、工业等领域的应用持续推进的过程中,我们可以看到在文教、家庭、社区、娱乐等市场中,视频监控的渗透也在持续提升,泛安防市场的发展给予行业新的成长动力。

风险提示:国内政府及大客户的订单投入和实施进度不及预期;中美贸易战以及国际贸易争端发展超预期;创新业务发展不及预期以及产品竞争带来盈利能力下降。

5、江海股份 (002484)

近期动态及最新财务数据:

公司发布 2019 年三季报,前三季度销售收入同比增长 7.6%为 14.8 亿元,归属于上市公司股东的净利润同比下降 4.8%为 1.7 亿元,基本 eps 同比下降 4.8%为 0.2081 元。

公司发布 2019 年半年报,上半年销售收入同比上升 5.8%为 9.6 亿元人民币,归属上市公司股东净利润同比下降 5.1%为 1.0 亿元人民币,基本 eps 同比下降 5.1%为 0.13 元。

核心投资观点:

1) 上游产能逐步释放解决公司订单执行: 公司 2018 年在上游受到环保限产的影响下仍然能够实现收入和利润的有效成长,预计在 2019 年随着铝箔产能逐步释放,化成箔和腐蚀箔的供给也不再成为公司的瓶颈,因此随着新老客户订单规模的推进,公司将会继续维持稳健的成长特性。

2) 自身产能建设推进: 公司在湖北罗田新建的产能有望在 2019 年逐步释放,对于公司现有南通产能不仅是有效的补充,更为重要的是新建产能在设施、资源、人力方面的高效提升也将会为公司的盈利能力提升带来正面作用。

3) 产品技术能力推进: 公司在传统铝电解电容方面有着良好的竞争力,同时也在积极推动薄膜电容器、超级电容器的技术水平和产品市场认可,随着过去几年的努力,公司有望逐步实现产品市场的有效扩张。

风险提示:电容器价格下降幅度超预期;上游原材料市场供给出现不稳定情况;薄膜电容器和超级电容器市场拓展速度不及预期。

五、风险提示

终端新品实际需求增速不及预期；

终端产品中在无线通信、传感器、人机交互等功能方面的创新无法达到消费者认可；

贸易争端带来的终端需求变化以及产业链影响的不确定性；

国产化自主可控的产业政策推出与落地实施不及预期风险。

行业评级体系

收益评级：

领先大市—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 10%以上；

同步大市—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-10%至 10%；

落后大市—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 10%以上；

风险评级：

A —正常风险，未来 6 个月投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动；

B —较高风险，未来 6 个月投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动；

分析师声明

蔡景彦声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据，特此声明。

本公司具备证券投资咨询业务资格的说明

华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告，是证券投资咨询业务的一种基本形式，本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向本公司的客户发布。

免责声明：

本报告仅供华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准，如有需要，客户可以向本公司投资顾问进一步咨询。

在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发、篡改或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华金证券股份有限公司研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

华金证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

风险提示：

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。投资者对其投资行为负完全责任，我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

华金证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区锦康路 258 号（陆家嘴世纪金融广场）13 层

电话：021-20655588

网址： www.huajinsec.com